股票代號：7858

芝普企業股份有限公司

E-CHEM ENTERPRISE CORP.

民國一一四年度年報

本年報查詢網站：公開資訊觀測站 http:// mops.twse.com.tw

公司網頁：https://www.echemsemi.com/

刊印日期：中華民國一一五年五月二十九日

一、本公司發言人：

姓名:劉小茜

職稱：副總經理

電話：(03)365-3300

電子郵件信箱：invest@echemsemi.com

代理發言人：趙文義

職稱：總經理

電話：(03)365-3300

電子郵件信箱：invest@echemsemi.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司及工廠之地址：桃園市八德區豐成街 22 號

總公司及工廠之電話：(03)365-3300

分公司之地址：無

分公司之電話：無

三、辦理股票過戶機構：

名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

地址：臺北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

網址：https://www.ctbcbank.com

電話：(02) 6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師：

簽證會計師：莊碧玉會計師、尤志峰會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：www.deloitte.com.tw

電話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用。

六、公司網址：https://www.echemsemi.com/

目錄

壹、 致股東報告書 1
貳、 公司治理報告 4
一、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 4
二、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 12
三、 公司治理運作情形 17
四、 簽證會計師公費資訊 39
五、 更換會計師資訊 39
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 40
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 40
八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 42
九、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 43
參、 募資情形 44
一、 股本來源 44
二、 主要股東名單 45
三、 公司股利政策及執行狀況 45
四、 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 45
五、 員工、董事及監察人酬勞 45
六、 公司買回本公司股份情形 46
七、 公司債辦理情形 46
八、 特別股辦理情形 46
九、 海外存託憑證辦理情形 46
十、 員工認股權憑證辦理情形： 47
十一、 限制員工權利新股辦理情形 48
十二、 併購（包括合併、收購及分割）辦理情形 48
十三、 資金運用計畫執行應記載事項 48
肆、 營運概況 49
一、 業務內容 49
二、 市場及產銷概況 61
三、 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 69
四、 環保支出資訊 69
五、 勞資關係 69
六、 資通安全管理 70
七、 重要契約 71
伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 72
一、 財務狀況 72
二、 財務績效 73
三、 現金流量 73
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 74
五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 74
六、 風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 75
七、 其他重要事項 79
陸、 特別記載事項 80
一、 關係企業相關資料 80
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 80
三、 其他必要補充說明事項 80

壹、致股東報告書

114 年度營收表現較去年同期大致持平，半導體製程相關產品維持穩定的營收貢獻，特用化學相關產品之營收及利潤比例均持續成長。半導體及電子高階製程產品應用，是近年芝普的主要營運項目，展望115年，仍持續此方向發展，陸續提升產品規格符合客戶需求，並積極發展持續高成長的AI、HBM製程及次世代環保清洗劑，以實現 115年營運目標及未來發展藍圖。

一、114年度營業結果：

(一)114年度營業計劃實施成果

本公司114年度營業收入淨額為新台幣1,509,079仟元，較113年度的1,519,950仟元，小幅下滑0.7%；在本期淨利方面為新台幣57,146仟元，較113年度的63,930仟元，下滑10.6%。

單位：新台幣仟元

單位：新台幣仟元	114 年度		113 年度		增減情形	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
營業收入	1,509,079	100.0	1,519,950	100.0	(10,871)	(0.7)
營業成本	(1,158,147)	(76.7)	(1,181,635)	(77.7)	23,488	(2.0)
營業毛利	350,932	23.3	338,315	22.3	12,617	3.7
營業費用	(277,073)	(18.4)	(266,211)	(17.5)	(10,862)	4.1
營業利益	73,859	4.9	72,104	4.7	1,755	2.4
營業外收入及支出	(3,270)	(0.2)	6,807	0.4	(10,077)	(148.0)
稅前淨利	70,589	4.7	78,911	5.2	(8,322)	(10.5)
本期淨利	57,146	3.8	63,930	4.2	(6,784)	(10.6)
淨利歸屬於母公司業主	57,146	3.8	63,930	4.2	(6,784)	(10.6)
每股盈餘 (元)	2.58		2.97		(0.39)	(13.1)

(二)預算執行情形：114年度未公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析：

114 年度營業收入營業毛利較 113 年度無大幅變動，惟因營業外收入及支出減少，致使淨利相較 113 年度減少；資產報酬率、權益報酬、稅前純益佔實收資本額比率及純益率皆因稅後淨利之減少相對應的降低。

單位：新台幣仟元

	單位：新台幣仟元	**114 年度**	**113 年度**	**增減比例(%)**
財務收支	營業收入	1,509,079	1,519,950	(0.7)
	營業毛利	350,932	338,315	3.7
	淨利歸屬於母公司業主	57,146	63,930	(10.6)
獲利能力	資產報酬率	5.6%	7.2%	(22.2)
	權益報酬率	10.8%	13.3%	(19.2)
	稅前純益佔實收資本額比率	31.7%	38.1%	(16.7)
	純益率	3.8%	4.2%	(10.0)
	每股盈餘(元)	2.58	2.97	(13.1)

(四)研究發展狀況：

本公司深耕半導體及特用化學品領域，始終將研究發展視為維持企業競爭力的核心動能 。為因應全球半導體製程持續往先進節點及先進封裝演進，本公司持續加大研發投入，強化與國際大廠之技術合作，致力於開發符合環保趨勢與高效能需求之關鍵材料及配方。

二、114年度營業計畫概要

(一)年度之經營方針

114 年度跨足半導體與載板製程，成功導入半導體製程用蝕刻液、綠色環保型清洗劑、前端製程光阻去除、SVHC 限制物質取代品開發、剝膜促進劑等，這些突破性的成果，不僅強化了我們在半導體與載板產業的競爭優勢，也展現了我們對綠色製造與永續發展的長期承諾，為產業帶來更環保、高效的創新解決方案。

在 115 年，本公司將持續深化技術研發，推動半導體製程與環保永續技術的發展，並聚焦以下五大策略方向，以提升產品競爭力並符合全球產業趨勢：

A.半導體製程SVHC限制物質取代品開發及量產

B.半導體蝕刻液開發及量產

C.產品回收再利用製程研究

D.載板製程蝕刻液開發及量產

E.半導體前端製程光阻去除進入量試

為強化技術創新與全球競爭力，本公司積極與國際半導體廠商展開合作，共同開發先進封裝技術所需的關鍵材料與製程技術。我們將專注於以下四大研發領域：

A.先進封裝用暫時性接著膠

B.先進封裝所需切割及研磨膠帶

C.RDL層所需感光型低介電樹酯

D.下世代中介層及基板材料

(二)預期銷售數量及重要產銷政策

本公司主要係依據當年度銷售情況、市場需求及產業發展，訂定隔年度之銷售業績，預估本公司未來營業規模仍可持續成長，對財務業務狀況帶來正面助益。

三、未來公司發展策略

半導體製程及高階載板製程之相關化學品，為芝普之核心產品與技術發展領域，以客戶製程需求為導向，持續開發產品以累積成長動能，並逐步擴展製造量能，積極投入持續高成長的AI、HBM製程及次世代環保清洗劑，期使達成營收及獲利雙向成長的目標。

興建中的配製及倉儲廠區預計115年上半年完工落成，未來將增加自有產品的生產能量及降低相關存儲成本提升營運效能。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

在全球地緣政治緊張與美中貿易戰持續升級的背景下，半導體及電子零組件供應鏈加速向台灣及非中國地區轉移，台灣作為全球關鍵樞紐之戰略地位日益顯著。本公司受惠於市場供應鏈轉向在地化採購的趨勢，憑藉深耕業界三十餘年的技術底蘊，提供精準且具彈性的技術解決方案，於高階製程與先進封裝應用領域中展現出穩定的成長實績。

面對國際歐美日大廠長期佔據市場及大陸同業低價競爭的挑戰，本公司採取差異化競爭策略，專注於切入高階邏輯晶片、特殊IC及車用電子等高壁壘領域。透過與上下游供應商建立深厚的戰略合作關係，提供客戶定製化服務，並藉由領先的製程技術突破研發瓶頸，使產品性能達到或超越國際標準，同時協助客戶有效降低運行成本，進而鞏固市場地位並擴大全球市佔影響力。

因應全球對低碳排放與ESG永續經營的嚴格法規要求，本公司將環保趨勢轉化為核心競爭優勢，積極投入環保無毒、環境友善之先進材料開發。

芝普企業股份有限公司

董事長　　林士堯

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事資料及監察人資料

1.董事及監察人資料

115 年 4 月 28 日

職稱	國籍或注冊地	姓名	性別年齡	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	約瑟投資有限公司	—	112.6.20	115.1.29	3 年	260,443	1.17%	260,443	1.17%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中華民國	代表人 林士堯	男 61~ 65	101.7.11	115.1.29	3 年	211,042	0.95%	211,042	0.95%	—	—	—	—	中原大學應用物理學系碩士 欣興電子(股)公司董事長資深特助兼明興光電執行長及聯興光電董事長 恆顥科技(股)公司總經理 時緯科技(股)公司總經理 奇美光電(股)公司副總經理 技迪科技(股)公司董事 台康科技(股)公司	約瑟投資有限公司董事長 E-CHEM HOLDING CO., LTD. 董事長 PROCHEM HOLDING CO., LTD. 董事長 PALLATECH CO., LTD.董事長				

職稱	國籍或注冊地	姓名	性別年齡	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
															董事長 統寶光電(股)公司資深副總經理					
副董事長	中華民國	王尊武	男61-65	78.3.25	115.1.29	3年	224,672	1.01%	224,672	1.01%	195,000	0.88%	—	—	國立清華大學化學系學士 芝普企業(股)公司董事長 芝普企業(股)公司董事長兼總經理	璨星投資(股)公司董事長 德非投資(股)公司董事長	董事	徐素斐	配偶	—
董事	中華民國	德非投資股份有限公司	—	115.1.29	115.1.29	3年	2,777,723	12.49%	2776,723	12.49%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中華民國	代表人徐素斐	女61-65	78.3.25	115.1.29	3年	224,007	1.01%	195,000	0.88%	224,672	1.01%	—	—	國立清華大學化學所 芝普企業(股)公司研發主管	璨星投資(股)公司監察人 德非投資(股)公司監察人	副董事長	王尊武	配偶	—
董事	中華民國	曾國典	男61-65	78.3.25	115.1.29	3年	195,865	0.88%	195,865	0.88%	—	—	—	—	國立清華大學化學系學士 芝普企業(股)公司副總經理 新應材(股)公司副總經理 世選科技(股)公司總經理 北京旭成華達科技有限公司總經理 亞太科技(股)公司副執行長 伊默克化學科技	芝普融祥(上海)貿易有限公司董事長 昆山芝普融祥貿易有限公司董事長 上海彤程電子材料有限公司常務副總經理	—	—	—	—

職稱	國籍或注冊地	姓名	性別年齡	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
															(股)公司副總經理					
董事	中華民國	林福川	男 66-70	97.6.12	115.1.29	3年	612,598	2.75%	612,598	2.75%	—	—	—	—	逢甲大學化工系	台灣琦麗樹脂化工股份有限公司監察人	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	黃見駱	男 60-65	115.1.29	115.1.29	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	台灣科技大學機械工程技術研究所 成功大學機械工程學系	天虹科技(股)公司董事長暨總經理 鑫虹先進(股)公司董事長 彪富國際投資(股)公司董事長 展虹國際(股)公司董事長 宇虹科技(股)公司董事長 輝虹科技(股)公司董事長 泉勝科技(股)公司監察人 Gimetek(Sinagapore)Pte.Ltd.董事 傅晶電子(上海)有限公司監察人 映思科技(股)公司董事長	—	—	—	—

職稱	國籍或注冊地	姓名	性別年齡	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數(股)	持股比率	股數(股)	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	李有田	男 70-75	115.1.29	115.1.29	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	台灣大學商學系工商管理組 美國賓州大學華頓商學院 MBA 美國賓州大學電機學院電腦碩士 台灣大學園藝系農學博士	樹花園(股)公司董事長 田瑞投資(股)公司董事長 達方電子(股)公司獨立董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	李惠如	女 55~60	115.1.29	115.1.29	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	政治大學經營管理學程碩士 東吳大學會計系學士	廣鴻會計師事務所所長 台安傑國際天使投資(股)公司董事暨財務長 中橫健行開發企業(股)公司董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	彭冠宇	男 45-50	115.1.29	115.1.29	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	國立中央大學企業管理學系碩士	台積電慈善基金會執行長 崑山科技大學企業管理系兼任教授				

2.董事屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例：

日期：115 年 4 月 28 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
約瑟投資有限公司	林士堯	95.72%
德非投資股份有限公司	王尊武	32.64%
	徐素斐	7.04%
	王榮德	30.16%
	王榮徹	30.16%

3.各該前十名股東屬法人股東者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名股東之名稱及其持股比例：不適用

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
約瑟投資有限公司 代表人： 林士堯	•相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料。 •未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	—
德非投資(股)公司 代表人： 徐素斐	•相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料。 •未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	—
王尊武	•相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料。 •未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	—
曾國典	•相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料。 •未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	—
林福川	•相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料。 •未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	—
黃見駱	•相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料。 •未有公司法第 30 條各款情事之一。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考	—
李有田	•相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料。 •未有公司法第 30 條各款情事之一。		1
李惠如	•相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料。 •未有公司法第 30 條各款情事之一。		—

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
彭冠宇	•相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料。 •未有公司法第 30 條各款情事之一。	公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	—

5.董事會多元化政策及獨立性：

(1)董事會多元化政策

本公司共 9 席董事，其中 2 席董事為女性，本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有專業知識與技能及產業經歷等，相信多元化政策有助提升公司整體表現。未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，強化本公司之公司治理能力。本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

條件 姓名	基本條件與價值					專業背景與能力							
	國籍	性別	具員工身分	年齡(歲)	獨立董事任期年資	營運判斷能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	財務及會計分析能力
約瑟投資有限公司 代表人：林士堯	中華民國	男	—	61-65	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
王尊武	中華民國	男	—	61-65	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
德非投資(股)公司 代表人：徐素斐	中華民國	女	—	61-65	—	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—
曾國典	中華民國	男	—	61-65	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

條件 姓名	基本條件與價值					專業背景與能力							
	國籍	性別	具員工身分	年齡(歲)	獨立董事任期年資	營運判斷能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	財務及會計分析能力
林福川	中華民國	男	—	66-70	—	—	✓	—	✓	—	✓	✓	—
黃見駱	中華民國	男	—	61-65	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
李有田	中華民國	男	—	70-75	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
李惠如	中華民國	女	—	55-60	—	—	✓	—	✓	—	✓	✓	✓
彭冠宇	中華民國	男	—	45-50	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

(2)董事會獨立性

本公司董事會成員董事 9 席，包含 4 席獨立董事，業經 115 年 1 月 29 日股東臨時會選任之。除副董事長王尊武與法人董事代表人徐素斐間具有配偶關係外，其餘逾過半之董事間未具有配偶或二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：　　115 年 4 月 28 日　單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	趙文義	男	中華民國	114.03.10	100,000	0.45%	—	—	—	—	國立清華大學科技管理研究所碩士 飛升(上海)電子科技有限公司總經理 冠捷科技有限公司總裁特助 禾鉿(股)公司研發協理	芝普融祥(上海)貿易有限公司總經理 昆山芝普融祥貿易有限公司總經理	—	—	—	—
副總經理兼財會主管	劉小茜	女	中華民國	111.07.11	36,993	0.17%	—	—	—	—	中央大學企業管理系碩士 欣銓科技(股)公司專案副處長 安成國際藥業(股)公司行政暨財會處協理 中華商業銀行襄理	網橋科技(股)公司監察人	—	—	—	—
開發部協理	陽若欽	男	中華民國	99.01.01	128,966	0.58%	175,411	0.79%	—	—	中原大學化學系(肄) 宏逸(股)公司業務專員 迪凱企業(股)公司業務專員	—	—	—	—	—
稽核主管	林祈芸	女	中華民國	114.04.11	12,549	0.06%	—	—	—	—	義守大學會計系學士 芝普企業(股)公司會計部資深副理 龍樺快遞有限公司會計專員	—	—	—	—	—

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

(一)一般董事及獨立董事之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
																現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	約瑟投資有限公司代表人：林士堯(註1)	10,882	10,882	–	–	1,885	1,885	144	144	12,911 22.59%	12,911 22.59%	1,560	1,560	–	–	200	–	200	–	14,671 25.67%	14,671 25.67%	–
副董事長	王尊武(註1)																					
董事	璨星投資(股)公司代表人：徐素斐																					
董事	楊禮華(註2)																					
董事	曾國典																					
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：不適用。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																						

註1：配有司機者，公司每年給付該司機1,450,000元之相關報酬，不計入酬金。

註2：楊禮華目前為本公司會計經理。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	璨星投資(股)公司(代表人：徐素斐)、曾國典、楊禮華	璨星投資(股)公司(代表人：徐素斐)、曾國典、楊禮華	璨星投資(股)公司(代表人：徐素斐)、曾國典	璨星投資(股)公司(代表人：徐素斐)、曾國典
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—	—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—	楊禮華	楊禮華
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	約瑟投資有限公司(代表人：林士堯) 、王尊武	約瑟投資有限公司(代表人：林士堯) 、王尊武	約瑟投資有限公司(代表人：林士堯) 、王尊武	約瑟投資有限公司(代表人：林士堯) 、王尊武
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	共 5 人	共 5 人	共 5 人	共 5 人

(二)監察人之酬金

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
監察人	林福川	—	—	580	580	—	—	580 1.01%	580 1.01%	—
監察人	劉啟民									

註：監察人林福川於 115 年 1 月 29 日股東臨時會選任為董事，監察人劉啟民於 115 年 1 月 29 日辭任。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	林福川、劉啟民	林福川、劉啟民
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	共 2 人	共 2 人

(三)總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	林士堯	2,258	2,258	108	108	710	710	756	–	756	–	3,832 6.71%	3,832 6.71%	–
總經理	趙文義													—

註：114 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 9 日由董事長林士堯先生暫代總經理；新任總經理趙文義先生於 114 年 3 月 10 日到任，並於 114 年 3 月 27 日經董事會追認，同日董事長林士堯先生免除暫代。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	林士堯	林士堯
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	趙文義	趙文義
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	共 2 人	共 2 人

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元；%

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
經理人	總經理	趙文義	—	1,655	1,655	2.90
	副總經理兼財會主管	劉小茜				
	稽核主管	林祈芸				
	開發部協理	陽若欽				

註：財會主管劉小茜於 115 年 1 月 1 日晉升為副總經理，並繼續兼任財會主管職務。

(五)本公司及合併報表所有公司於最近二年度度支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1.最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例：

單位：新台幣仟元；%

職稱	113 年度				114 年度			
	酬金占稅後純益比例(%)				酬金占稅後純益比例(%)			
	本公司		財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司	
	總額	%	總額	%	總額	%	總額	%
董　事	15,751	24.64	15,751	24.64	12,911	22.59	12,911	22.59
監察人	710	1.11	710	1.11	580	1.01	580	1.01
總經理、副總經理	—	—	—	—	3,832	6.71	3,832	6.71

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序，與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 董事及監察人

本公司給付董事及監察人之酬勞，係依公司章程之規定提撥，由董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常水準決議後於股東會報告。本公司設有薪資報酬委員會，董事、監察人及經理人之酬金，由薪資報酬委員會評估及提出建議，經提報董事會決議後並於股東會報告。

(2) 總經理及副總經理

總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞等，薪資水準係依其所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準訂定；員工酬勞的提撥標準係遵循公司章程，且設有薪資報酬委員會，其酬金應由薪資報酬委員會評估及提出建議，經提報董事會決議後發放。

(3) 訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

綜上，本公司董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，皆依公司章程、人事規章、對公司營運參與程度、貢獻價值及參酌同業水準等要素訂定之，除考量應與經營績效呈正相關，亦同時評估公司未來可能面臨之營運風險、相關法令規定及產業景氣波動等風險因素，適時檢討酬金制度，謀求公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

自 114 年 1 月 1 日起至 115 年 3 月本公司董事會開會 9 次，董事及監察人出席情形如下：

	職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
本屆 115/01/29 後	董事長	約瑟投資有限公司 代表人：林士堯	3	-	100%	115/01/29 連任
	副董事長	王尊武	3	-	100%	115/01/29 連任
	董　事	德非投資有限公司 代表人：徐素斐	3	-	100%	115/01/29 新任
	董　事	曾國典	3	-	100%	115/01/29 連任
	董　事	林福川	3	-	100%	115/01/29 新任
	獨立董事	黃見駱	3	-	100%	115/01/29 新任
	獨立董事	李有田	3	-	100%	115/01/29 新任
	獨立董事	李惠如	3	-	100%	115/01/29 新任
	獨立董事	彭冠宇	3	-	100%	115/01/29 新任
上屆 115/01/29 前	董事長	約瑟投資有限公司 代表人：林士堯	6		100%	115/01/29 解任
	副董事長	王尊武	6		100%	115/01/29 解任
	董　事	璨星投資有限公司 代表人：徐素斐	6		100%	115/01/29 解任
	董　事	曾國典	6		100%	115/01/29 解任
	董　事	楊禮華	6		100%	115/01/29 解任
	監察人	林福川	5		83%	115/01/29 解任
	監察人	劉啟民	6		100%	115/01/29 解任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無此情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

日期	議案內容	董事姓名	利益迴避原因	參與表決情形
114.04.10	通過審查本公司執行業務董事薪酬案	林士堯 王尊武 徐素斐 楊禮華	出席董事林士堯、王尊武、徐素斐、楊禮華為本案利害關係人	於本案之討論及表決過程依法分別離席迴避
	通過本公司113年度個別董監事酬勞分配案	林士堯 王尊武 徐素斐 曾國典 楊禮華	出席董事林士堯、王尊武、徐素斐、曾國典、楊禮華為本案利害關係人	於本案之討論及表決過程依法分別離席迴避
114.11.13	通過董事及經理人114年度年中績效獎金給付金額案	林士堯 王尊武 徐素斐 楊禮華	出席董事林士堯、王尊武、徐素斐、楊禮華為本案利害關係人	於本案之討論及表決過程依法分別離席迴避
	通過董事報酬案	曾國典	出席董事曾國典為本案利害關係人	於本案之討論及表決過程依法離席迴避
114.12.23	通過本公司董事及經理人114年度年終獎金	林士堯 王尊武 徐素斐 楊禮華	出席董事林士堯、王尊武、徐素斐、楊禮華為本案利害關係人	於本案之討論及表決過程依法分別離席迴避
	通過本公司通過董事及經理人115年度調薪	王尊武 徐素斐 楊禮華	出席董事王尊武、徐素斐、楊禮華為本案利害關係人	於本案之討論及表決過程依法分別離席迴避
115.3.26	通過114年度個別董監酬勞分配案	林士堯 王尊武 徐素斐 曾國典 林福川	出席董事林士堯、王尊武、徐素斐、曾國典、林福川為本案利害關係人	於本案之討論及表決過程依法分別離席迴避
	114年度個別董監酬董事及經理人專案獎金給付金額案	林士堯 王尊武 徐素斐	出席董事林士堯、王尊武、徐素斐為本案利害關係人	於本案之討論及表決過程依法分別離席迴避

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：不適用。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(一)本公司已於115年1月29日股東臨時會完成董事全面改選，選任四名獨立董事，並依法設置由全體獨立董事組成之審計委員會，以強化公司治理機制。

(二)本公司已為董事承保董監責任險。

(三)本公司董事每年應完成主管機關規定之進修時數，並鼓勵董事會成員參與各類專業課程，以持續精進專業知識，提升職能，確保其專業優勢。同時，定期進行相關法規宣導，以確保符合法令要求。

(二)審計委員會運作情形：

最近年度(114)及截至年報刊印日審計委員會共開會 1 次(A)，獨立董事出席情形如下(註)

職稱	姓名	實際出席次數**(B)**	委託出席次數	實際出席率(%)**(B/A)**	備註
獨立董事	黃見駱	1	0	100%	
獨立董事	李有田	1	0	100%	
獨立董事	李惠如	1	0	100%	
獨立董事	彭冠宇	1	0	100%	

註：本公司於 115 年 1 月 29 日股東臨時會全面改選董事，由獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證交法第 14 條之 5 所列事項：所有議案均經審計委員會全體成員二分之一以上同意並提董事會決議通過。

審計委員會日期及期別	議案內容	所有審計委員會意見	公司對審計委員會意見之處理
115/03/26 第一屆第一次	研發設備資本支出案	全體出席委員無異議照案通過	提請 115 年第二次董事會決議並依照董事會決議辦理。
	114 年度董監酬勞及員工酬勞案		
	114 年度營業報告書及財務報表案		
	114 年度盈餘分配案		
	114 年度內部控制制度聲明書案		
	訂定「永續資訊管理辦法」案		
	修訂「內部核決權限管理辦法」		
	修訂內部控制制度案		
	修訂「股東會議事規則」		
	本公司為間接投資大陸子公司芝普融祥(上海)貿易有限公司背書保證案		

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)最近年度及截至年報刊印日止本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下：

1.稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核董事長後，每月透過電子郵件送各獨立董事查閱稽核報告結果。

2.稽核主管列席審計委員會及董事會並提出稽核業務報告，各獨立董事適時掌握公司內部稽核狀況。

會議日期	出席人員	溝通重點	結果
115/3/26	獨立董事彭冠宇 獨立董事黃見駱 獨立董事李惠如 獨立董事李有田 稽核主管林祈芸	1.114 年稽核業務執行結果報告 2.114 年內部控制制度設計及執行之有效性評估	獨立董事對報告內容無其他意見，並建議針對系統權限訂定各職能之標準權限表，以資遵循。

(二)本公司簽證會計師定期以會議形式向獨立董事報告財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項若有特殊狀況亦會立即向獨立董事報告最近年度及截至年報刊印日止本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形如下：

會議日期	出席人員	溝通重點	結果
115/3/26	獨立董事彭冠宇 獨立董事黃見駱 獨立董事李惠如 獨立董事李有田 會計師尤志峰 會計師陳映蓉	1.審計品質與溝通效率檢討 2.IPO 與內控專審時程 3.關鍵里程碑確認	充分討論並知悉，無異議。

(三)監察人參與董事會運作情形：

最近年度(114)及截至年報刊印日止董事會共開會 9 次，監察人列席情形如下(註)

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
監察人	林福川	6	0	83%	114 年 1 月 1 日至 115 年 1 月 29 日，以監察人身份應出席 7 次
監察人	劉啟民	7	0	100%	114 年 1 月 1 日至 115 年 1 月 29 日，以監察人身份應出席 7 次

註：本公司於 115 年 1 月 29 日股東臨時會全面改選董事，由獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權。改選前開會次數為 7 次，改選後開會次數為 2 次。

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）。

本公司監察人每次召開董事會時均有監察人列席，必要時會透過股東會及董

事會與會期間或以其他方式與相關人員溝通。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：

1. 本公司內部稽核主管定期與監察人溝通稽核報告結果、次年度稽核計畫以及內部控制執行情形等，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
2. 本公司監察人與簽證會計師溝通狀況良好溝通，監察人得隨時聯繫簽證會計師。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無此情形。

(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	v		本公司經 114 年 11 月 13 日董事會決議訂定「公司治理實務守則」，並於公司網站及證券主管機關指定之資訊申報網站揭露，亦依公司治理實務守則訂定完善的內部控制制度。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 （一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	v		本公司已依公司治理實務守則及內部控制制度，訂有「股東權益作業」、「股務作業」等辦法並予以實施，確保股東權益。同時，本公司設有發言人、代理發言人、股務專責單位處理股東建議、疑義或糾紛及訴訟事宜。另為維持與股東暢通之溝通管道，本公司網頁已揭露聯繫方式，股東可透過電話或電子郵件等方式反應意見，本公司將依相關規定辦理。	無重大差異。
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	v		本公司遇停止過戶如股東會、除權息，由股務專責單位向集保中心申請取得股東名冊暨相關資料，充分掌握及瞭解主要股東，並於每年年報中揭露前十大股東名單及其相互持股情形。同時，法人董事之前十大股東若為法人，亦已於年報中進一步揭露該法人之主要股東，充分掌握主要股東之最終控制者名單。	無重大差異。
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	v		本公司與關係企業訂有「內部控制制度」、「職務授權及代理人管理辦法」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「子公司監理辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			規範人員、資產及財務之管理，以執行風險評估及建立適當之防火牆機制。	
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	v		本公司已建置「防範內線交易管理作業辦法」、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關規範，規範內部人迴避與其職務有關之利益衝突，亦不得利用所知悉之未公開資訊洩漏予他人，以防止從事內線交易。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責 （一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	v		本公司於 115 年 1 月 29 日股東臨時會通過修訂「董事選任程序」，在董事會結構訂有多元化方針。另董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採候選人提名制，並遵守「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。	無重大差異。
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		v	本公司已依法設置薪資報酬委員會且運作正常，並於 115 年 1 月 29 日股東臨時會後，由選任之獨立董事組成審計委員會，目前尚無增設其他功能性委員會之迫切需要，擬斟酌未來法令制度與業界發展狀況加以制訂。	未來將視法令及實際需求情況設置其他功能性委員會
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	v		本公司規劃於 115 年 12 月，由董事會訂定「董事會績效評估辦法」，依法每年針對董事會及個別董事成員進行績效評估。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	v		本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性與適任性，要求會計師每年提供獨立聲明書外，另製作「會計師獨立性及適任性評估標準檢查表」，針對可能影響獨立性項目逐一評估，經評估會計師無發現任何有可能損及其獨立性及適任性之情事。最近一次為 114/12/23 董事會決議通過會計師之獨立性及適任性評估案。	無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	v		本公司目前由總經理室及專職人員處理公司治理相關事務，包含董事會及股東會之會議相關事宜、協助董事及監察人相關法令之遵循，並於 115 年 3 月 26 日董事會決議通過設置公司治理主管一名。	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	v		本公司設有發言人及代理發言人，作為公司對外發表意見之管道，另本公司於網站設有投資人專區，指派相關人員擔任專責窗口，並設立電子信箱供利害關係人聯絡之用，遵循內部控制制度辦理相關回應事宜。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	v		本公司已委任中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務。	無重大差異。
七、資訊公開 （一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	v		本公司網站已架設，並揭露公司財務業務相關資訊及公司治理運作情形。	無重大差異。
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	v		本公司資訊之蒐集及揭露有相對應之專責單位負責，與公司有關問題由公司發言人及代理發言人擔任資訊回應之窗口；另本公司召開之法人說明會，皆依相關法令規定辦理。	其他資訊之揭露，未來將依相關法令及制度執行。
（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		v	本公司目前為興櫃公司，依據證券交易法第三十六條及公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法規定公告及申報。	同摘要說明
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準	v		1. 本公司設有職工福利委員會，並訂有相關規章，保障員工權益。 2. 本公司為維護股東權益，使投資大眾便於瞭解公司之經營狀況，於本公司網站架設『投資人關係』專區，投資人除可於公開資訊觀測站查詢公司相關資訊外，亦可透過本公司網站獲取重要資訊。 3. 本公司與供應商及利害關係人均有暢通之溝通申訴管道，由各專屬	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？			部門負責溝通、協調，以保障其應有之合法權益。 4. 本公司不定期提供董事需注意之相關法規資訊及相關單位舉辦之專業知識進修課程資訊，並依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定，安排董事相關進修。 5. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定「風險管理政策與程序」，進行風險評估，並落實內部稽核作業。 6. 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好及穩定之合作關係，以創造公司利潤。 7. 公司為董事購買責任保險之情形：每年皆投保董監事暨重要職員責任保險以降低營運風險。 8. 本公司於董事會議事規則明訂董事對於其利害相關之議案討論及表決應予以迴避。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司尚未列入受評公司。				

(五)本公司薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料：

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人暨獨立董事	黃見駱	請參閱年報第 7 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。		0
獨立董事	李有田			0
獨立董事	李惠如			0
獨立董事	彭冠宇			0

2.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員計 3 人，本屆委員任期：114 年 3 月 27 日至 115 年 1 月 29 日。

(2)本公司第二屆薪資報酬委員會委員計 4 人，本屆委員任期：115 年 1 月 29 日至 118 年 1 月 28 日。

最近年度薪資報酬委員會第一屆開會 3 次(A)，第二屆開會 1 次(A)，委員資格及出席情形如下：

	職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
第一屆	召委	李有田	3	0	100%	
	薪酬委員	黃見駱	3	0	100%	
	薪酬委員	李惠如	3	0	100%	
第二屆	召委暨獨立董事	黃見駱	1	0	100%	
	獨立董事	李有田	1	0	100%	
	獨立董事	李惠如	1	0	100%	
	獨立董事	彭冠宇	1	0	100%	

其他應記載事項：

1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。

2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

3.薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

開會日期 屆次	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.4.7 第一屆第一次	1.審查董事、監察人及經理人各項薪資酬勞項目案 2.審查本公司執行業務董事薪酬 3.審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍 4.審查經理人酬金給付金額 5.通過本公司 113 年度個別董監酬勞分配案	所有出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過
114.10.29 第一屆第二次	1.修訂「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文，並更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 2.訂定本公司基層員工範圍案 3.審查稽核主管薪資報酬案 4.審查董事及經理人 114 年度年中績效獎金給付金額案 5.董事報酬案	所有出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過
114.12.23 第一屆第三次	1.本公司薪資報酬委員會 115 年度工作計畫案 2.本公司經理人晉升暨薪酬調整案 3.本公司董事及經理人 114 年度年終獎金案 4.本公司通過董事及經理人 115 年度調薪案 5.修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理作業辦法」	所有出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過
115.3.26 第二屆第一次	1.114 年度董監酬勞及員工酬勞案 2.114 年度個別董監酬勞分配案 3.114 年度個別經理人員工酬勞分配案 4.董事及經理人專案獎金給付金額案 5.修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案	所有出席委員同意通過	提交董事會由全體出席董事同意通過

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)		v	1.本公司已訂定「永續發展實務守則」及「永續資訊管理辦法」，目前由董事會授權高階管理階層負責規劃與推動永續發展相關策略，以確保公司營運方向與永續發展趨勢相符。 2.為進一步強化永續發展推動機制，預計 2026 年啟動 ESG 教育訓練與化學品產業相關 ESG 發展計畫，依據實際執行後依據報告書資料補充說明持續關注國內外法規及產業趨勢，適時調整永續發展策略，並強化公司在環境保護、社會責任及公司治理方面的表現，以提升企業長期競爭力。	本公司目前為興櫃公司，未來將配合相關法規，逐步規劃與落實相關管理政策。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？		v	本公司已依法訂定「永續發展實務守則」及「道德行為準則」，並已將環保議題列入決策考量，後續將陸續制定相關準則。	本公司目前為興櫃公司，未來將配合相關法規，逐步規劃與落實相關管理政策。
三、環境議題 （一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	v		1.環境管理系統與綠色生產 (ISO 14001) 公司依循 ISO14001 環境管理系統標準，建立嚴謹的環境治理架構並取得第三方驗證。我們深知化學產業對環境的潛在影響，因此將「污染預防」與「資源循環」視為核心營運責任。透過定期管理審查，針對製程中的廢水處理及化學廢棄物之減量訂定具體指標，並投入低耗能、低污染的製程技術改良，主動降低營運對生態環境的衝擊。 2.職業健康安全與化學品防護 (ISO 45001)	無重大差異。

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			在化學作業環境中，員工的生命安全與健康是本公司不可妥協的防線。我們根據 ISO 45001 職業健康與安全管理系統國際標準，針對化學品曝露、製程壓力/溫度風險、以及緊急洩漏應變等領域建立嚴密的管理機制。 3.我司預計於 115 年導入依循 GHG Protocol 架構之溫室氣體盤查制度，透過系統性盤查以精準識別高能耗製程及主要排放來源，據以推動節能減碳改善方案。	
（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	v		公司每年規劃節電各項措施，提高能源使用效率，並控管廢棄物之產出量，及分類資源回收物，並委託合格清理廠商，進行回收再利用。	無重大差異。
（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	v		本公司已訂定「永續發展實務守則」，據以評估氣候變遷對企業現在及未來之潛在風險與機會，並規劃相關因應措施。現階段正積極展開相關數據蒐集作業，並透過教育訓練強化同仁永續意識，後續將依盤查結果與實際營運需求，逐步落實環境管理目標。	無重大差異。
（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	v		公司已統計用水量及廢棄物總重量，惟尚未統計溫室氣體排放量；目前已將碳盤查、節能減碳等相關議題列入決策考量，日常營運並以環保節能原則進行管理。	無重大差異。
四、社會議題 （一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	v		本公司遵循勞動基準法等相關法規保障員工之權益，並依法訂定「招募任用作業辦法」及「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」等相關管理政策與辦法。	無重大差異。

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	v		本公司依據「職工福利金條例」成立福利委員會並訂定「職工福利委員會福利辦法」實施合理員工福利措施，且制定「員工考績管理辦法」，每年執行一次員工績效考核，並將經營績效經由董事會通過後，反映於員工之薪酬。	無重大差異。
（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	v		本公司採取多項措施來確保員工的工作環境安全與健康。公司遵循職業安全衛生法規，於員工到職當日即進行職業安全衛生教育訓練以建立職場安全，並每年進行消防逃生訓練、急救訓練、工安訓練、環境安全訓練等內部教育訓練。每年提供全體員工完善的健康檢查，並定期舉辦心理健康講座和壓力管理課程，幫助員工維持身心健康。114 年無員工職災情形發生亦未有火災情形發生。	無重大差異。
（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	v		為配合人力資源發展之規劃，本公司訂有「教育訓練管理辦法」，依功能屬性與職級別設計課程，提高員工專業能力及知識技能。	無重大差異。
（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	v		本公司對產品與服務之行銷與標識，皆有遵循相關法規及國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。另本公司網站提供聯絡窗口及電子信箱，提供客戶提問及建議管道。	無重大差異。
（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循	v		本公司對供應商進行徵信並評估過去是否有不良紀錄，同時關注供應商是否有違反環保、職安與人權之記錄。如發現有違反企業社會責任之虞者，經查證屬實，本公司將停止與該供應之往來。	無重大差異

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
相關規範，及其實施情形？				
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		v	本公司尚未編制永續報告書。	本公司目前為興櫃公司，未來將配合相關法規，逐步規劃與落實相關管理政策。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 114 年 11 月 13 日董事會決議通過訂定「永續發展實務守則」，未來將依循此準則，逐步完善相關政策與管理制度。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司目前為興櫃公司，未來將配合相關法規，逐步規劃與落實相關管理政策。				

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾?	v		本公司已訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，及於公司各項規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層皆有簽屬「行為準則及誠信聲明書」積極落實。	無重大差異。
（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	v		本公司依據「誠信經營守則」積極規劃防範不誠信行為方案。目前除依預定時程推動中，未來規劃公司擬將誠信經營列為新進人員必備宣導文件，以建立員工之法遵意識；同時，本公司正研擬檢舉機制與配套處理程序，確保具備完善的監督與溝通管道，以落實誠信經營之企業核心價值。	無重大差異。
（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	v		本公司已訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，並於全體員工季會中，對在職員工進行宣導。	無重大差異。
二、落實誠信經營				
（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	v		1.本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。 2.本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。	無重大差異。
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經	v		本公司各部門主管負責誠信經營政策與防範方案之制定及執行,由本公司公司治理主管負責督導相關之運作與查核,並定	無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？			期向董事會報告執行情形。並於次年向董事會報告前一年度誠信經營執行情形。	
（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	v		1.依據本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第十一條利益迴避制度，建立從董事會到全體員工的「利益衝突迴避機制」，嚴禁利用職務或公司資源謀取私利，以確保決策與營運的公正性。 2.公司網站提供聯絡方式，內部設置檢舉信箱，提供內外部建言管道。	無重大差異。
（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	v		本公司已建有會計制度及內部控制制度，並落實執行，且由內部稽核人員定期查核制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會；另本公司為確保制度之設計及執行持續有效，每年進行檢視及修訂作業，以建立良好公司治理與風險管控機制，作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。	無重大差異。
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	v		本公司於115/05/20全員季會進行誠信經營宣導，以深化同仁之誠信意識。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	v		本公司訂有「員工獎懲辦法」，其中規定員工若主動舉發偽造或冒領、舞弊或有危害公司權益等情事，經查證屬實者得予以記功獎勵。	無重大差異。
（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	v		本公司已建立完善之舉報體系，於企業內網設置檢舉信箱（含匿名機制）供同仁使用，並於公司官網設立外部申訴管道；所	無重大差異。

評　估　項　目	運　作　情　形(註 1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			有案件均由專責人員依程序辦理，確保檢舉管道之暢通與案件處理之公正性。(114 年未有接獲及受理外部檢舉案件及員工直接檢舉案)	
（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	v		本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」內明訂公司人員涉不誠信行為之處理程序及保護檢舉人之措施。	無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	v		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露「誠信經營作業程序及行為指南」，日常經營以此規範並執行。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)： 本公司將隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及員工提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策即推動措施，以提升落實誠信經營之成效。於 115 年 11 月 13 日董事會修訂誠信經營守則，修訂專責單位以強化運作。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.114 年度至截稿刊印前股東會決議事項

日期	項次	內容
114/05/08 股東常會	1	盈餘轉增資發行新股案
	2	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
	3	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
	4	修訂本公司「股東會議事規則」案
	5	修訂本公司「公司章程」案
115/01/29 股東臨時會	1	「公司章程」修訂案
	2	「董監事選舉辦法」修訂並更名為「董事選任程序」案
	3	「股東會議事規則」修訂案
	4	「取得或處分資產處理程序」修訂案
	5	「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
	6	股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案
	7	本公司董事九席(含獨立董事四席)全面改選案

2.114 年度至截稿刊印前董事會決議事項：

開會日期	項次	決議事項
114/3/27	1	本公司總經理任命追認案
	2	本公司發行之員工認股權憑證執行轉換普通股及訂定增資發行新股基準日案
	3	本公司 113 年度董監事酬勞與員工酬勞案
	4	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案
	5	本公司 113 年度盈餘分配案
	6	本公司盈餘轉增資發行新股案
	7	修訂本公司內部核決權限表案
	8	修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」案
	9	修訂本公司「印鑑管理辦法」案
	10	本公司 114 年度簽證會計師之委任及報酬案
	11	本公司擬向金融機構申請貸款額度案
	12	召集 114 年度股東會相關事宜案
	13	訂定本公司「薪資報酬委員會運作管理作業辦法」案
	14	訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
	15	訂定本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案
	16	委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案
	1	修訂本公司「公司章程」案

114/4/10	2	本公司113年度「內部控制制度聲明書」案
	3	本公司擬向金融機構申請貸款額度案
	4	本公司為境外子公司PALLATECH CO., LTD.背書保證案
	5	本公司發言人及代理發言人任命案
	6	本公司內部稽核主管異動案
	7	審查董事、監察人及經理人各項薪資報酬項目案
	8	審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案
	9	審查本公司執行業務董事薪酬案
	10	本公司113年度個別董監事酬勞分配案
	11	審查經理人酬金給付金額案
	12	113年度經理人員工酬勞分配案
	13	召集114年度股東會相關事宜案
114/7/14	1	修訂本公司「內部控制制度總則」案
	2	本公司擬向中國信託商業銀行申請貸款及衍生性金融商品額度案
	3	本公司擬向兆豐國際商業銀行申請貸款及衍生性金融商品額度案
	4	本公司為間接投資大陸子公司芝普融祥(上海)貿易有限公司背書保證案
	5	擬訂定本公司113年盈餘轉增資發行新股基準日及相關作業事宜案
	6	擬訂定本公司113年現金股利基準日及相關作業事宜案
114/8/8	1	配合勤業會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案
	2	本公司114年第二季合併財務報表案
	3	本公司廠區擴建資本支出計畫追加案
	4	本公司廠區擴建G棟之廠務設施及生產設備工程資本支出案
114/11/13	1	股票申請上櫃案
	2	訂定本公司基層員工範圍案
	3	修訂本公司「公司章程」案
	4	修訂本公司內部控制制度案
	5	修訂本公司「董監事選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案
	6	本公司董事九席(含獨立董事四席)全面改選案
	7	解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
	8	訂定本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會運作管理辦法」案
	9	訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
	10	訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案
	11	修訂本公司「股東會議事規則」案
	12	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

	13	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
	14	訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案
	15	修訂本公司各項管理辦法案
	16	修訂本公司「內部核決權限管理辦法」案
	17	修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」，並更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」案
	18	稽核主管薪資報酬案
	19	董事及經理人 114 年度年中績效獎金給付金額案
	20	董事報酬案
	21	股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案
	22	召集 115 年度第一次股東臨時會相關事宜案
114/12/23	1	本公司 115 年度預算案
	2	本公司 115 年度稽核計畫案
	3	簽證會計師獨立性與適任性評估案
	4	本公司 115 年度簽證會計師之委任及報酬案
	5	改派孫公司芝普融祥(上海)貿易有限公司及昆山芝普融祥貿易有限公司總經理案
	6	本公司經理人晉升暨薪酬調整案
	7	本公司董事及經理人 114 年度年終獎金案
	8	本公司通過董事及經理人 115 年度調薪案
	9	修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理作業辦法」案
	10	修訂本公司「內部核決權限管理辦法」案
	11	修訂本公司「印鑑管理辦法」案
	12	本公司擬向台北富邦商業銀行申請貸款及衍生性金融商品額度案
	13	本公司擬向國泰世華銀行申請貸款及衍生性金融商品額度案
	14	修訂本公司及子公司 PALLATECH CO., LTD.擬向合作金庫商業銀行申請貸款及衍生性金融商品額度案
115/1/28	1	本公司廠區擴建資本支出計畫追加案
	2	本公司廠區擴建之 G 棟廠務設施及生產設備工程資本支出追加案
115/1/29	1	選舉董事長及副董事長案
	2	擬委任本公司第一屆審計委員會委員案
	3	擬委任本公司第二屆薪資報酬委員案
115/3/26	1	研發設備資本支出案
	2	114 年度董監酬勞及員工酬勞案
	3	114 年度個別董監酬勞分配案
	4	114 年度個別經理人員工酬勞分配案
	5	董事及經理人專案獎金給付金額案

	6	114 年度營業報告書及財務報表案
	7	114 年度盈餘分配案
	8	本公司 114 年度盈餘分派現金股利案
	9	114 年度內部控制制度聲明書案
	10	訂定「風險管理政策與程序」案
	11	訂定「智慧財產權管理辦法」案
	12	訂定「永續資訊管理辦法」案

(十一)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	莊碧玉 尤志峰	114.1.1~114.12.31	1,720	1,777	3,497	註 1

註 1：非審計公費服務內容為稅務簽證、工商變更登記服務、內控專審。

公司有下列情事之一者，應揭露會計師公費：

(一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費減少金額及原因：無此情形。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	114 年 8 月 8 日經董事會通過		
更換原因及說明	配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，自民國 114 年第 2 季起，將本公司之簽證會計師由簡明彥會計師及莊碧玉會計師變更為莊碧玉會計師及尤志峰會計師		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼承)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意	有		會計原則或實務

見			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	✓	
	說明		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	莊碧玉、尤志峰
委任之日期	114 年 8 月 8 日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 ：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)持股變動情形

職稱	姓名	114 年度		截至 115 年 4 月 28 日	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	約瑟投資有限公司	15,895	—	—	—
	代表人：林士堯	(28,871)	—	—	—
副董事長	王尊武	(146,851)	—	—	—
董事	德非投資(股)公司	451,222	—	(1,000)	

職稱	姓名	114 年度		截至 115 年 4 月 28 日	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
	代表人：徐素斐 (就任日期:115/1/29)	(37,033)	—		—
董事	曾國典	(33,117)	—	—	—
董事	林福川 (就任日期:115/1/29)	(50,438)	—	—	—
獨立董事	黃見駱 (就任日期:115/1/29)	—	—	—	—
獨立董事	李有田 (就任日期:115/1/29)	—	—	—	—
獨立董事	李惠如 (就任日期:115/1/29)	—	—	—	—
獨立董事	彭冠宇 (就任日期:115/1/29)	—	—	—	—
總經理	趙文義	106,500	—	(6,500)	—
副總經理 兼財會主管 兼公司治理主管	劉小茜 (副總經理就任日期:115/1/1) (公司治理主管就任日期:115/3/26)	4,793	—	(40,500)	—
開發部協理	陽若欽	7,871	—	—	—
稽核主管	林祈芸	1,639	—	(6,000)	—
10%之股東	德非投資(股)公司	(37,033)	—	(1,000)	—
10%之股東	璨星投資(股)公司	144,113	—	(11,000)	
董事	璨星投資(股)公司 (解任日期:115/1/29)	144,113	—	(11,000)	
董事	楊禮華 (解任日期:115/1/29)	(10,971)	—	—	—
監察人	劉啟民 (解任日期:115/1/29)	241,530	—	—	—
監察人	林福川 (解任日期:115/1/29)	(50,438)	—	—	—

(二)股權移轉相對人為關係人資訊：

姓 名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係	股 數	交易價格
林士堯	贈與	114.03.11	林○恩	法人董事代表人之子女	50,000	—
劉○行	贈與	114.03.11	劉啟民	監察人之子女	65,000	—
王○明	贈與	114.03.11	劉啟民	監察人之配偶	82,000	—
劉○君	贈與	114.03.11	劉啟民	監察人之子女	65,000	—
璨星投資(股)公司	處份	114.04.08	趙文義	本公司之總經理	100,000	20.060 元

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115 年 04 月 28 日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
璨星投資(股)公司	3,988,710	17.94	—	—	—	—	—	—	
代表人：王尊武	224,672	1.01	195,000	0.88	—	—	璨星投資(股)公司、德非投資(股)公司	董事長	
德非投資(股)公司	2,776,723	12.49	—	—	—	—	—	—	
代表人：王尊武	224,672	1.01	195,000	0.88	—	—	璨星投資(股)公司、德非投資(股)公司	董事長	
林福川	612,598	2.75	99,882	0.45	—	—	林奕辰 林奕廷 林奕忻	二親等以內之親屬	
楊瓊玲	441,000	1.98	—	—	—	—	—	—	
曾素芝	417,482	1.88	—	—	—	—	曾素珍	二親等以內之親屬	
林奕辰	414,300	1.86	—	—	—	—	林福川 林奕廷 林奕忻	二親等以內之親屬	
林奕廷	413,461	1.86	—	—	—	—	林福川 林奕辰 林奕忻	二親等以內之親屬	
林奕忻	409,250	1.84	—	—	—	—	林福川 林奕辰 林奕廷	二親等以內之親屬	
曾素珍	351,616	1.58					曾素芝	二親等以內之親屬	
呂連子	338,817	1.52	—	—	—	—	—	—	

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

114 年 12 月 31 日；單位：千股

轉投資事業（註）	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
E-CHEM HOLDING CO., LTD.	2,227	100%	-	-	2,227	100%
PROCHEM HOLDING CO., LTD.	2,187	100%	-	-	2,187	100%
PALLATECH CO., LTD.	100	100%	-	-	100	100%
芝普融祥(上海)貿易有限公司	(註)	100%	-	-	(註)	100%
昆山芝普融祥貿易有限公司	(註)	100%	-	-	(註)	100%

註：為有限公司，並無發行股份

參、募資情形

一、股本來源：

115 年 4 月 28 日；單位：股；新台幣元

年/月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
104.08	10	30,000,000	300,000,000	17,999,750	179,997,500	員工認股權憑證換發新股 1,177,500 元	-	註 1
113.07	10	30,000,000	300,000,000	18,935,737	189,357,370	盈餘轉增資 9,359,870 元	-	
	10	30,000,000	300,000,000	19,871,724	198,717,240	資本公積轉增資 9,359,870 元	-	註 2
	20.1	30,000,000	300,000,000	20,494,724	204,947,240	員工認股權憑證換發新股 6,230,000 元	-	
113.12	17.93	30,000,000	300,000,000	20,698,739	206,987,390	員工認股權憑證換發新股 2,040,150 元	-	註 3
114.04	17.93	30,000,000	300,000,000	20,879,818	208,798,180	員工認股權憑證換發新股 1,810,790 元	-	註 4
114.07	10	30,000,000	300,000,000	22,237,007	222,370,070	盈餘轉增資 13,571,890 元	-	註 5

註 1：104 年 8 月 3 日府經授中字第 10433604750 號。

註 2：113 年 7 月 16 日府經登字第 11390956130 號。

註 3：114 年 1 月 14 日府經登字第 11490704940 號。

註 4：114 年 4 月 22 日府經商行字第 11490839980 號。

註 5：114 年 7 月 29 日府經商行字第 11490989290 號。

115 年 4 月 28 日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	22,237,007	7,762,993	30,000,000	興櫃股票

二、主要股東名單：

115 年 4 月 28 日；單位：股；%

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
璨星投資股份有限公司	3,988,710	17.94%
德非投資股份有限公司	2,776,723	12.49%
林福川	612,598	2.75%
楊瓊玲	441,000	1.98%
曾素芝	417,482	1.88%
林奕辰	414,300	1.86%
林奕廷	413,461	1.86%
林奕忻	409,250	1.84%
曾素珍	351,616	1.58%
呂連子	338,817	1.52%

三、公司股利政策及執行狀況：

(一)公司章程所訂定之股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，撥補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限；其餘依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，則為當年度未分配盈餘，其餘額併同以前年度未分配盈餘為可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之。

本公司股利政策，考量公司發展計畫、未來年度營運預算規劃之資金需求、兼顧股東利益等因素，就當年度未分配盈餘提撥不低於百分之二十分配股東股息及紅利，其餘為未分配盈餘；惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之三十時，得不予分配。分配股東股息及紅利時得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額的百分之三十，但得視當年度實際獲利及資金需求狀況，經股東會決議調整之。

(二)本次股東會擬議股利分派之情形

本公司 114 年盈餘分派案，業經 115 年 3 月 26 日董事會擬議分配現金股利金額 28,463,369 元。

(三)預期股利政策有無重大變動：無。

四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用

五、員工、董事及監察人酬勞：

(一)公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十五為員工酬勞，前述員工酬勞數額中，應提撥不低於 20%為基層員工分派酬勞，由董事會決議以股票或現金分派

發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞，僅得以現金方式為之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(二)本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基 礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

本公司之員工、董事及監察人酬勞係依章程所定之成數範圍估列，若估列數與董事會決議實際配發金額有差異時，則按會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

(三)董事會通過分派酬勞情形

1.以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形。

本公司業經 115 年 3 月 26 日董事會決議通過 114 年度董監酬勞及員工酬勞案，董監酬勞計新台幣 2,465,196 元，員工酬勞計新台幣 9,449,919 元，均以現金發放。

2.以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司 114 年度並未以股票分派員工酬勞，故不適用。

3.股東會報告分派酬勞情形及結果

本公司 114 年度董監酬勞及員工酬勞案業經 115 年 3 月 26 日董事會決議通過，將於 115 年 6 月 26 日股東常會報告。

(四)前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司業經 115 年 3 月 26 日董事會決議通過 114 年度董監酬勞新台幣 2,465,196 元及員工酬勞新台幣 9,449,919 元以現金發放，與帳列數值無差異，並於 115 年 6 月 26 日股東常會報告。

六、公司買回本公司股份情形：無此情事。

七、公司債辦理情形：無此情事。

八、特別股辦理情形：無此情事。

九、海外存託憑證辦理情形：無此情事。

十、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：本公司無尚未屆期之員工認股權憑證。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

單位：千股；新台幣元

身分別	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	執行長	林士堯(註 3)	478	2.15%	398 88 (註 4)	20.1 17.93 (註 4)	8,000 1,578	2.19%				—
	策略長	王尊武(註 3)										
	協理	陽若欽										
	協理	李 O 庭(註 2)										
	財會	劉小茜										
員工	資深經理	吳 O 陽	288	1.30%	101 189 (註 4)	20.1 17.93 (註 4)	2,030 3,389	1.30%	(註 5)			—
	經理	楊禮華										
	經理	尤 O 凱(註 2)										
	副理	楊 O 蓮(註 2)										
	副理	徐 O 傑										
	副理	林祈芸										
	副理	蔡 O 穎										
	副理	蔡 O 玲										
	副理	黃 O 芬(註 2)										
	副理	廖 O 梅(註 2)										

註 1：係以取得時之職稱做為揭露

註 2：已離職

註 3：林士堯先生與王尊武先生分別於 113 年 7 月 1 日與 112 年 8 月 15 日卸任執行長與策略長之職務。

註 4：依本公司員工認股權辦法，認股權憑證發行後，遇有本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資時，除調降認股價格外，對於已授與但未行使認股權利之員工認股權憑證，本公司將按股本變動之比率，以調降後之價格為認股價格，增發認股權憑證。

註 5：111 年員工認股權憑證於 114 年 4 月 4 日已屆期，員工未執行 15 千股的部分，皆已失效。

(三)最近三年度及截至年報日止私募員工認股權憑證辦理情形：無此情事。

十一、限制員工權利新股辦理情形：無此情事。

十二、併購（包括合併、收購及分割）辦理情形：無此情事。

十三、資金運用計畫執行應記載事項：

截至年報刊印日之前一季止，本公司並無前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者之情形。

肆、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：

1.公司所營業務之主要內容

依經濟部登記所載之主要營業項目如下

C801010　基本化學工業

C801030　精密化學材料製造業

C801100　合成樹脂及塑膠製造業

C801110　肥料製造業

C801990　其他化學材料製造業

C802080　環境用藥製造業

C802120　工業助劑製造業

C802990　其他化學製品製造業

F107050　肥料批發業

F107080　環境用藥批發業

F107170　工業助劑批發業

F107200　化學原料批發業

F107990　其他化學製品批發業

F113030　精密儀器批發業

F119010　電子材料批發業

F207050　肥料零售業

F207080　環境用藥零售業

F401010　國際貿易業

J101060　廢（污）水處理業

ZZ99999　除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

本公司主要從事半導體製程用化學品及材料（Semiconductor Chemicals and Materials）及特用化學品及材料（Specialty Chemicals and Materials）之代理、研發、生產及銷售，主要業務領域涵蓋：半導體、被動元件、印刷電路板等產業製程所需之高純度化學品、表面處理化學品、功能性化學品、化學材料以及相關原物料。

2.營業比重

單位：新台幣仟元；%

年度 品項	113 年度		114 年度	
	營業收入	營業比重	營業收入	營業比重
半導體製程用化學品及材料	1,087,121	71.52	1,032,151	68.40
特用化學品及材料	431,376	28.38	475,799	31.53
其他	1,453	0.10	1,129	0.07
合計	1,519,950	100.00	1,509,079	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目

產品類別	產品項目
半導體製程用 化學品及材料	(1) 薄膜製程沉積材料 (2) 黃光製程用化學品 (3) 蝕刻清洗製程用化學品 (4) 特殊製程應用化學品 (5) 設備零配件用料
特用化學品及材料	(1) 被動元件製程用化學品及材料 (2) 高階載板製程用化學品及材料 (3) 特用化學品及材料

4.計畫開發之新商品(服務)

本公司致力於研發兼具環保、安全與高效能的創新產品，涵蓋從設計開發到製造銷售的全方位流程。我們持續深化與國際大廠的策略夥伴關係，接軌先進製程與封裝技術，在遵循國際法規的前提下，精準滿足市場需求。

計畫開發之新產品	
半導體材料	(1) CPO 製程用蝕刻液 (2) 先進封裝製程清洗液 (3) 新世代蝕刻液 (4) 先進製程去光阻劑 (5) 先進封裝用材料、耗材
特用化學品 (IC 載板)	(1) 玻璃基板製程用蝕刻液 (2) 環保低危剝膜液 (3) 濕式化學品

(二)產業概況：

1.產業之現況及發展

本公司主要從事半導體製程用化學品及材料（Semiconductor Chemicals and Materials）及特用化學品及材料（Specialty Chemicals and Materials）之代理、研發、生產與銷售，主要業務領域涵蓋：半導體、被動元件、印刷電路板等產業製程所需之高純度化學品、表面處理化學品、功能性化學品、化學材料以及相關原物料。茲就其主要市場之發展狀況說明如下：

半導體產業

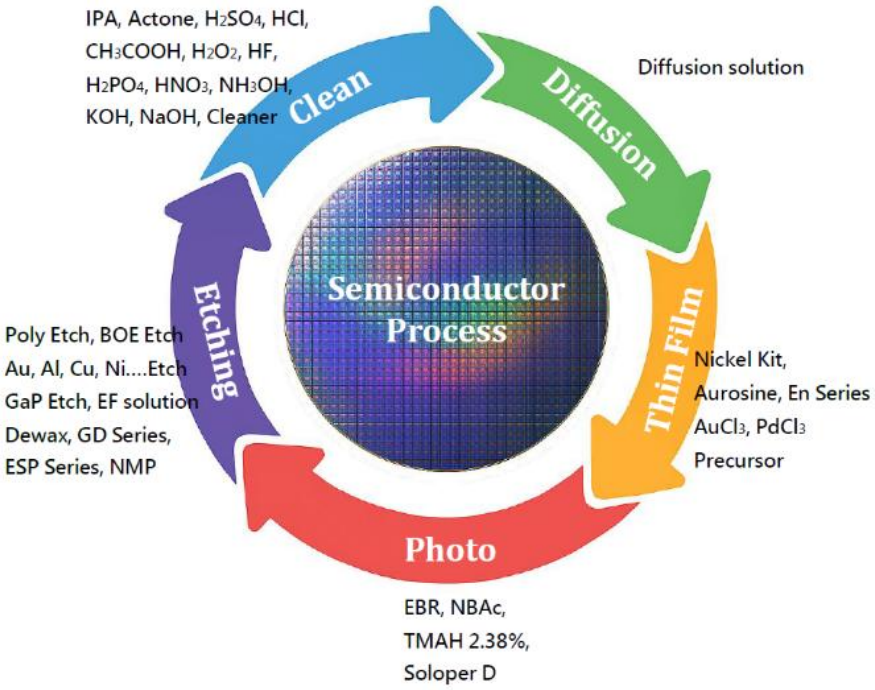
半導體產業隨著高階人工智慧（AI）對高效能運算（HPC）及高頻寬記憶體（HBM）的需求增加，以及終端 AI、高速傳輸、物聯網（IoT）等應用的持續發展，對高效能、低功耗晶片的需求將日益提升，先進製程技術與先進封裝將成為半導體產業未來十年持續成長的核心動力。另一方面，車用半導體市場涵蓋了支援車輛電氣化、連接性、自動駕駛與安全性等先進功能的關鍵元件，如微控制器、感測器、儲存設備與功率元件，雖 2024 年成長趨緩，惟隨著電動化與軟體定義汽車的發展，

未來整車所需半導體數量將持續上升。此外，全球對環境保護要求趨嚴，歐美對化學品的使用限制日益增加，台灣亦面臨空氣、水污染及化學物質管理的法規收緊，導致製造業廢棄物處理成本顯著上升，並推動半導體用化學品朝向更安全、低汙染、可回收與減碳方向發展。

根據工研院產科所上修 2026 年台灣半導體業產值，從 7.1 兆元上修至 7.7 兆元。IC 製造業產值達 5 兆 4,339 億元，年增 23.9%；晶圓代工產業產值 5 兆 1,317 億元，年增 23.1%。記憶體與其他製造產業產值 3,022 億元，年增 38.9%。產科所統計，2025 年台灣 IC 產業產值達新台幣 65,225 億元，年增 22.7%。IC 製造業為 4 兆 3,869 億元，年增 28.3%，其中晶圓代工為 4 兆 1,693 億元，年增 28.5%。記憶體與其他製造為 2,176 億元，年增 23.8%；IC 封裝業為 4,825 億元，年增 14.0%；比較 2025 與 2026 年，半導體產業、IC 製造業、晶圓代工及記憶體產業，年成長皆超過 10%以上，成長快速且巨大。根據 IDC 預測，2026 年半導體成長動能來自三大支柱：AI 基礎建設持續投入，帶動資料中心晶片營收大幅攀升；隨著企業為整合 AI 功能而升級硬體，換機潮加速，將推動 Client 端裝置市場穩健復甦；記憶體市場需求爆發期，受惠於 HBM 強勁需求及 DRAM /NAND Flash 供需吃緊，成為推升整體半導體產值的關鍵引擎。AI 加速器製造市場將迎來爆發性成長，預計 2026 年整體市場規模將激增 78%。受惠於 Google TPU 等 CSP 自研晶片的強勁需求，IDC 預估 2026 年 ASIC 年增率將高達 113%，高於 GPU 的 66%。長期而言，為了優化 TCO 與能源效率，CSP 持續擴大自研版圖，Anthropic 等模型開發商也將擴大採用 ASIC 系統，推動 ASIC 市場 2024-2029 年 CAGR 達 67%，超越 GPU 的 56%，成為 AI 運算的另一支柱。以上市場帶動 CoWoS 先進封裝擴張持續，產能年增 72%仍供不應求，2026 OSAT 市場預期成長 11%，台美 AI 晶片封裝比重持續攀升，更長遠來看，Yole Intelligence 的資料顯示 CPO 市場的整體營收將從 2024 年的 4,600 萬美元，走向 2030 年的 54 億美元，年複合成長率(CAGR)達到了驚人的 121%。

另外，歐盟及美國對工業製造中化學品使用之限制持續增加，觀察台灣經濟部產業發展署環保法規趨勢，空汙、水汙及化學物質管理亦趨嚴格，廢棄物處理成本近年隨著法規的改變數倍增加，台灣及大陸相關製造廠商使用之化學品皆持續朝向更安全、低汙染、再利用、減碳等方向發展。

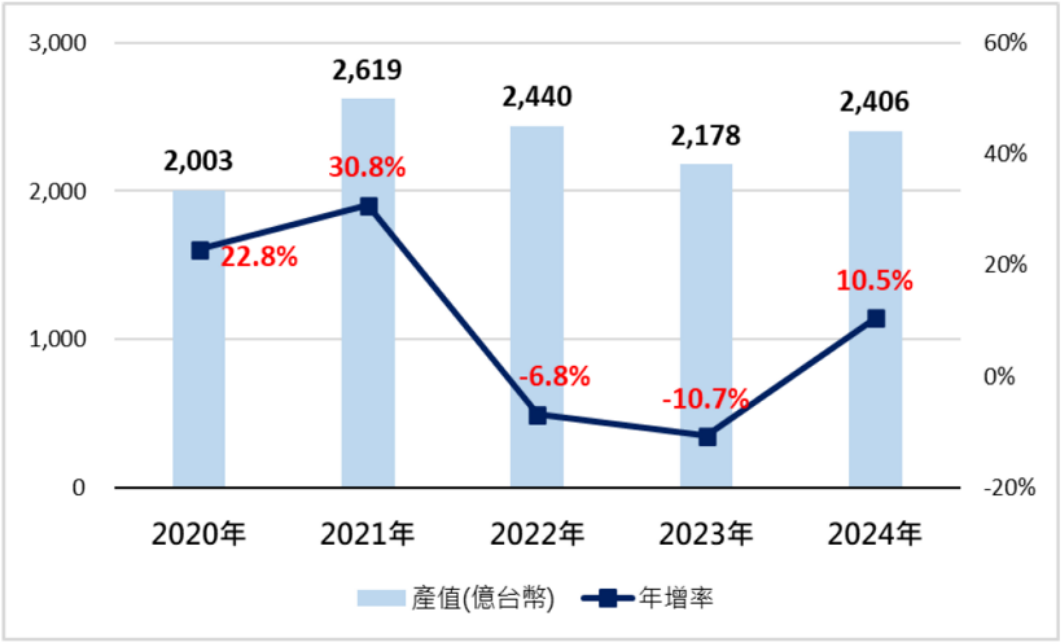
目前本公司所銷售半導體製程用化學品及材料主要用於半導體產業中之邏輯晶片、隨機存取記憶體晶片、通訊晶片、分離式元件、封裝，主要應用之製程領域係黃光(photo-lithography)、蝕刻(etching)、擴散(diffusion)、薄膜(thin-film)與化學機械研磨區(CMP)等，如下圖所示，促成台灣半導體產業具競爭優勢且冠居群倫的背後，即是半導體化學品，而本公司所提供之客製化產品，更是客戶於先進製程所需的關鍵元素之一。



被動元件產業

觀察我國被動元件產業產值及年增率走勢，2024 年以來，隨著終端庫存去化告一段落，回補庫存的需求漸趨浮現，且 AI 伺服器應用需求浮現、AI 手機、AI PC 陸續問世，支撐智慧手機、筆電等產品出貨表現，加上電動車應用需求仍呈小幅成長，推升被動元件市場需求漸趨回溫。受惠於 AI 伺服器出貨規模明顯走揚，台廠布局 AI 應用效益明顯發酵，電動車、自駕車等應用有效支撐汽車電子等應用出貨走揚，支撐台廠出貨表現。

圖一 我國被動電子元件產值及其年增率走勢



被動元件展望 2026 年上半年，在雲端服務供應商(CSP)業者增加投資下，對於 AI 伺服器的需求持續增加，AI 應用持續帶動被動元件高階積層陶瓷電容（MLCC）等在內的電容、電阻和電感等被動元件產品需求，明年 AI 應用仍是被動元件發展主要成長動能。

本公司長期致力於相關領域材料及化學品的開發，現行銷售產品已應用於中高端被動元件製造，並依據客戶需求提供各類關鍵耗材。透過與客戶的長期合作關係，不僅掌握市場發展趨勢，亦能即時回應並滿足客戶在短期、中期與長期的技術與產品開發需求。

載板及 PCB 產業

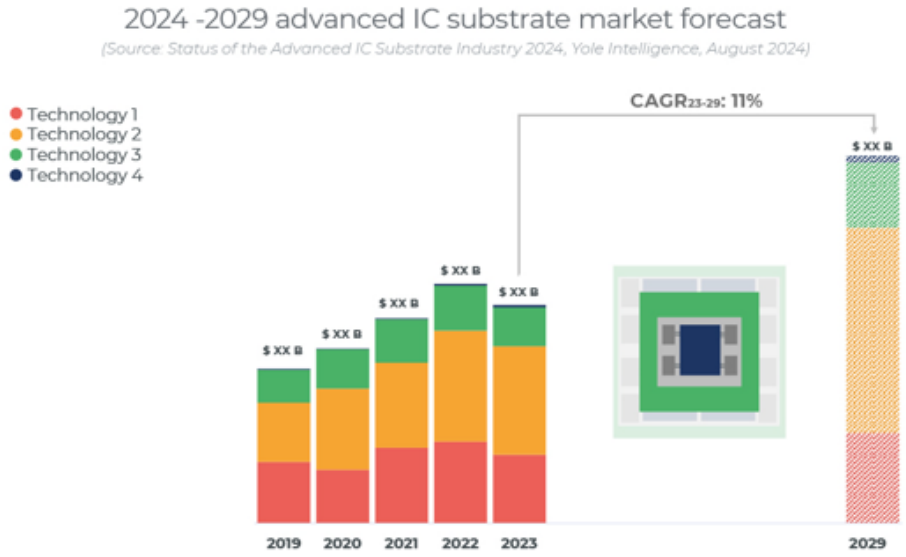
2025 年，受惠於 AI 伺服器與相關終端應用需求佳，正向推動全球 PCB 產品市場動能。2025 年全球印刷電路板產值約 81,465 百萬美元，年成長率約 5.3%。展望 2026 年，即便全球 PCB 產業仍面臨原材料價格波動、地緣政治等挑戰，但在 AI 伺服器、電動車、半導體等需求續旺的預期下，有利全球高階印刷電路板產值表現，下一代伺服器如 NVIDIA Rubin 架構將採用更高層數的 Midplane，層數可能高達 44 層。整體而言，估計 2026 年全球產值約 85,783 百萬美元，年成長率約 5.0%。

根據 Mordor Intelligence 的市場分析與預測數據顯示，全球 PCB 產值預計將於 2029 年成長至 965.7 億美元，預測 2024 至 2029 年複合年成長率將達到 4.87%。此數據顯示 PCB 產業將迎來穩健的成長趨勢，反映出市場需求與技術發展的持續擴張。

資料來源：Mordor Intelligence

全球載板隨著 AI 與 5G 的蓬勃發展，需求大幅提升，根據 Yole Group 預測，2023 至 2029 年的年均複合成長率（CAGR）將達 11%，市場規模可望達到 255.3 億美元。本公司之特用化學品銷售至高階載板及 PCB，除標準與高效產品外，是市場上最早開始響應市場對於環保無毒等趨勢投入相關研發廠商。目前已是高階載板化學品供應商中，極少數能同時滿足各項環保法規並能配合客戶製程進步的

品牌。



資料來源：Yole Group

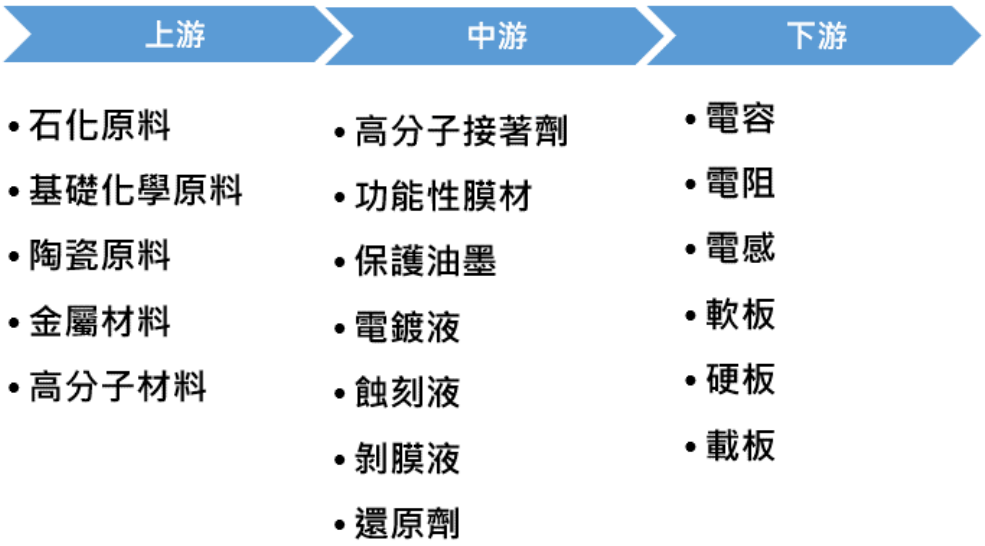
2.產業上、中、下游之間之關聯性

本公司於半導體晶片製造、載板、電路板及被動元件供應鏈中扮演著中游材料、化學品供應商的角色，供應高純度化學品、表面處理化學品、功能性化學品、化學材料以及相關原物料。茲將該產業之上、中、下游關聯性列示如下：

①半導體晶片製造供應鏈

上游	中游	下游
• 石化原料 • 基礎化學原料 • 陶瓷原料 • 金屬材料 • 高分子材料	• 電鍍液 • 蝕刻液 • 去光阻液 • 顯影液 • 黃光化學品 • 清洗液 • 沉積材料化學研磨相關材料	• 晶圓代工 • 記憶體製造 • 封裝測試

②特用化學產業供應鏈



目前整體被動元件產業關鍵成長動能已從傳統消費性電子轉向 AI，車用與通訊技術升級(5G,WiFi7)等應用。被動元件產業成長也由過去景氣循環主導，轉變為結構性成長。AI 相關應用為目前被動元件市場最主要成長動能。AI 伺服器的高功耗 AI 主晶片、高壓直流 HVDC 架構與晶片之間的資料高速傳輸對於高容值/高耐壓 MLCC、高頻電阻、高頻 MLCC 與高階電感/濾波器的需求帶動被動元件產品需求。隨著全球電動車和自動駕駛技術的加速普及，汽車電子已成為僅次於 AI 的第二大成長動能。高階應用的強勁拉貨效應，將持續優化相關供應商（如國巨、華新科）的產品組合與獲利結構。

臺灣是印刷電路板產業在全球市場中扮演關鍵角色。從終端應用來看，近十年臺灣 PCB 應用於通訊產品的比重相對高且呈現上升態勢，主要產品有智慧型手機、基地台、路由器等，其中又以智慧型手機為主要應用。2025 年，受惠於 AI 伺服器、低軌衛星、車用電子等新興應用所帶動的高階 PCB 產品需求，驅動台廠產能表現。整體而言，2025 年臺灣印刷電路板產值達新台幣 8,076.7 億元，年成長率約為 6.1%。展望 2026 年，在 AI 伺服器需求樂觀的預期下，加上相關應用擴散可期，臺灣身為供應鏈重要參與者，可望受惠。估計 2026 年臺灣印刷電路板產值可望進一步攀升至新台幣 8,585.6 億元，年成長率約 6.3%。

3.產品之各種發展趨勢

本公司專注於半導體、印刷電路板、二極體、發光二極體、平面顯示器、太陽能以及鋰電池等產業製程中，所需要的高純度化學品、表面處理化學品、功能性化學品、化學材料以及相關原物料。多年來陸續開發出多項應用於第三代半導體、高效能運算(AI)、HBM4、先進封裝、等製程用之化學品及材料，並導入晶圓製造、封裝測試及高階載板與印刷電路板客戶。藉由多年累積的製程材料開發經驗，本公司目前積極投入持續高成長的 AI、HBM4E、先進車用晶片製程材料及次世代環保清洗劑，目標滿足先進製程的客製化材料需求。

①半導體製程用化學品及材料

A.特殊清洗劑需求提升

全球積體電路領域技術快速更迭，製造技術從 10nm、7nm、5nm 至 3nm，化學品作為積體電路製造的必備材料，伴隨著下游先進封裝技術的快速發展，製程使用之化學品的客製化程度持續提高，特殊清洗劑具有較佳之性能與製程效益，可增加先進製程的良率及產出。半導體市場受惠於 AI 加速器的 AI 訓練需求增加、AI PC 的換機需求，以及隨著智慧型手機、伺服器、Wi-Fi 7 升級更高效能需要更多先進製程之應用，特殊清洗劑是半導體產業進入先進製程時代的必備材料。本公司掌握特殊清洗劑技術核心，長期與國際大廠合作，並不斷優化產品，符合客戶各技術節點需求。

B.環保洗劑需求成長

在全球各組織及相關法規要求下，更安全、環保且能降低廢棄物處理成本的環保洗劑成為市場需求趨勢。本公司已開發一系列符合各項環保法規的產品，並在市場及客戶端獲得驗證。

C.半導體供應鏈優勢

本公司位處於全球先進半導體晶片生產樞紐地帶核心，優越的地理位置提供了快速且具機動性供貨的絕佳條件與機會，更創造許多先進製程應用認證的先機，提供客戶迅速緊密的產品支援與售後服務，短程運輸減少碳足跡，進而創造成本優勢。

D.先進封裝引領市場成長

本公司已於 2017 年投入先進封裝市場產品開發，與國際廠牌合作，共同發展所需的製程用材料及清洗用化學品，已取得階段性成果，產品獲得終端客戶的高度評價及使用，目前客戶放量中擴大使用，下一代新產品也正積極進行測試中。另也針對先進封裝客戶未來需求，開發一系列耗材、RDL 用樹脂、散/導熱材料及 CPO 需求之材料。

②特用化學品及材料

A.被動元件之技術革新與需求擴張

被動元件是電子產品的基礎元件，廣泛應用於 PC、手機、平板電腦等各式各樣電子終端，與消費性電子市場有密切關係。除了 AI 帶來相關被動元件商機外，車用亦扮演長期成長關鍵動能。汽車電子化推升每台車 MLCC 用量達約 5 千顆，電動車每台用量更翻倍甚至破萬，相較傳統燃油車用量達 5~10 倍，未來在 ADAS、電動車滲透率持續提升之下，需求量將持續擴大。另外隨著第三代半導體氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)的廣泛運用，將帶來高功率大尺寸被動元件產品市場廣度增加，高階應用產品如電動車/車載充電器/未來車用無線充電於設計上，大尺寸/高電壓 NPO 積層陶瓷電容(MLCC)將大量取代原薄膜電容設計，5G 應用射頻元件大量增加，進而帶動低溫共燒陶瓷(LTCC)粉末需求增加。

對於電感元件來說產品無內裂、高感值、低熱變化已是當今首要，搭配客戶端需求分別可滿足冷壓、熱壓製程、高感低熱衰退變化，藉由產品組成搭配，能讓客戶有更多的製程空間做調整，已滿足終端客戶的需求。隨著終端產品需求的演進，本公司持續開發新世代電鍍鎳/錫，可滿足客戶在製程末端表面處理電鍍鎳/錫的應用選擇，有效避免酸性製程的參與及干擾，降低因末端電鍍製程所造成的產品瑕疵及異常發生。

B.聚焦載板及 PCB 先進製程與永續發展

本公司近年專注於載板先進製程及因應 ESG 減碳需求相關的產品開發，包含 mSAP/SAP 製程所需無毒、低 COD 的剝膜液，極細線路用的銅蝕刻劑，AI 高頻運算的 Chemical Bonding，Glass Substrate 發展不可缺少的玻璃蝕刻、TGV 技術等，協助客戶在未來製程能力開發上取得更有優勢的技術發展。

4.產品之競爭情形

①半導體製程用化學品及材料競爭情形

台灣作為全球半導體製造技術最先進且產能最大的國家，已成為全球供應鏈的關鍵樞紐。無論是追求尖端技術的領先企業，或是專注於成本效益的競爭者，皆將台灣視為戰略要地，積極布局以搶占市場份額；然而，半導體供應商最迫切需求的為精準專業、即時性、彈性化及高效率的問題解決能力及長期穩定的服務品質，以維繫客戶的信任與合作關係。這些關鍵要素正是國外廠商在文化差異與資源配置上難以全面滿足的挑戰，同時也成為台灣本土企業在半導體供應鏈中持續擴張並鞏固市場地位的核心競爭優勢之一。

本公司半導體主要產品為薄膜製程沉積材料、黃光製程用化學品及蝕刻清洗製程用化學品，茲就細項產品競爭情形簡述說明如下：

A.薄膜製程沉積材料

Precursor為薄膜製程沉積製程中的重要材料，全球供應商有德國Merck、美國Entegris、法國Air Liquid、台灣南美特、日本TCLC、韓國Hansol、中國南大、中國雅克等。本公司自2015年起，即關注到Precusor 在半導體製程中的重要性，積極開發大陸晶圓代工廠客戶，並與上游供應商及形成緊密的戰略合作關係。

近年來，受惠於中美貿易戰限制加劇，加上亞洲晶圓代工廠近幾年持續興建新廠，需求持續增加等因素，市場供應鏈逐步轉向台灣及中國製產品，本公司在此產品上的營收逐步穩定成長。雖然在低階產品上，受到來自大陸本土供應商，如南大、雅克等廠商的低價競爭，然本公司於業界已有累積超過30年業界經驗，可提供高階製程用料，並提供客戶較佳的品質和適當的成本，已於高階邏輯晶片、特殊IC及功率元件代工廠客戶取得一定的銷售實績與肯定。

B.黃光製程用化學品

黃光製程用化學品以半導體光阻顯影劑、定影劑、晶圓洗邊劑等為大量使用化學品項為標的，主要供應商為日本東應化、長春化工、勝一化工、歐普仕化學、三福化工等國內知名廠商。本公司與上游供應商均有長期合作良好關係，並為半導體客戶提供一站購足(One stop shop)服務，持續擴大市佔及市場影響力。

C.蝕刻清洗製程用化學品

蝕刻清洗製程用化學品市場中，專注於去光阻劑於半導體主要供應商有：德國Merck、美國Avantor、美國Dupont、美國KMG、日本TOK、日本Fujifilm、日本MGC及台灣添鴻等，全球主要8家去光阻及清洗劑生產商之產品發展皆已超過20年以上，其中市占率最高者為美國Dupont，因其在半導體去光阻領域發展最早，擁有眾多生產專利及多樣產品線；其次為日本TOK、美國Avantor。本公司相較其他競爭者雖屬新進公司，但本公司初入市場即選擇切入邏輯及功率晶片製程，目前已量產出貨，未來亦是本公司主力發展項目產品。另本公司近年專注於發展環保型去光阻產品，目前已導入晶圓代工廠，未來營收應可逐步成長。

②特用化學品及材料競爭情形

A.被動元件產品

台灣作為全球被動元件產業的領先者，規模僅次於日本。隨著美中貿易戰持續升級至科技戰，被動元件業者因產品本身具備「輕薄短小」的特性，在生產據點轉移上更具彈性，近年紛紛加速增設非中國的生產據點。除了透過生產據點多元化來降低風險外，台灣被動元件廠商也積極採取多樣化策略，例如技術升級、產品差異化以及市場定位調整，以維持競爭優勢。本公司長期投入台灣車用大廠電鍍表面處理產品的經營，產品競爭優勢為中性鍍液能有效抑制底材在電鍍過程中受到腐蝕。目前已獲得客戶肯定長期使用。期望能持續在產業升級過程中取得先機，抗衡來自日商ISHIHARA、美商DuPont等廠商的競爭。

B.載板及PCB產品

隨著AI伺服器、衛星通訊及車用電子的需求迅速增長，高階載板及HDI技術持續展現出強勁的成長動能。在過去十年中，本公司投入大量資源配合全球領導品牌開發先進製程需求，特別是在極細線路微影及增層相關製程的開發過程中，面對來自日本及歐洲同業的激烈競爭，我們的研發團隊成功突破技術瓶頸，開發出環保無毒、低碳排放且環境友善的產品，並且在未來10年先進製程所需的鈦、銅蝕刻產品取得海外客戶認證使用，這些產品在性能上達到或超越市場標準，同時顯著降低運行成本，並已成功投入量產線上。

(三)技術及研發概況：

1.技術層次及研究發展

(1)所營業務之技術層次及研究發展

本公司每年提撥相當比例之研發費用於既有產品線的升級、並持續增加不同產業的產品線。多年來與歐美、日本國際大廠合作，堅持提供最優良的產品及最專業的服務，以滿足客戶的差異化需求。

本公司設有專業的實驗室、無塵室、研發技術團隊，以提供完整的解決方案，並與客戶共同追求製程技術的創新與提升。持續提升、擴充各式精密儀器設備，包括 SEM(場發射掃描式電子顯微鏡)、橢圓偏光儀、ICP-Mass(感應耦合電漿質譜儀)、ICP-OES(感應耦合電漿光學發射光譜儀)、FT-IR(傅立葉轉換紅外線光譜儀)及 GC-MS(氣相層析質譜儀)等，可快速且準確的進行化學品分析，提供客戶服務的能力。在先進製程之需求可提供偵測極限達 ppt 等級之分析能力，並作為新製程化學品的應用開發分析工具。

整體而言，本公司主要研發策略為：

①對既有之產品線，不斷進行強化，配合客戶製程能力提升，提升產品效能並降低成本。

②致力於符合綠色化學品與未來環保需求趨勢之新產品開發，如 non-HA 去光阻劑、NMP/DMSO 取代品等。

(2)研究發展人員與其學經歷

單位：人；年

年度 學歷	113 年度		114 年度	
	人數	比率(%)	人數	比率(%)
博士	1	7.14%	1	6.67%
碩士	4	28.57%	6	40.00%
大專	9	64.29%	8	53.33%
合計	14	100.00%	15	100.00%

(3)最近四年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115 年度截至 3 月 31 日
研發費用	17,658	20,283	23,456	23,165	23,260
營業收入淨額	1,436,376	1,156,095	1,519,950	1,509,079	818,961
研發費用占營業收入比例	1.23	1.75	1.54	1.54	2.84

2.最近五年度開發成功之技術或產品技術類別

年度	開發成功之技術或產品
110 年度	貴金屬觸媒量產並增加轉化效率、半導體封裝用去光阻劑、半導體封裝用去光阻劑、車用晶片絕緣膠、防鏽劑及銀/銅防變色劑、導熱 PI 膜（日本市場）、感光介電層
111 年度	客製化金屬蝕刻液產品開發與量產、無電鍍金屬化製程化學品、EMI 遮蔽材料、導熱塗料、車用晶片暫時性接著膠、透明 PI 膜、GO/r-GO 分散液
112 年度	半導體光罩產業用去光阻劑、wafer reclaim 清洗液、隱形雷射切膠帶、ALD 前驅物原料
113 年度	半導體製程 SVHC 限制物質取代品開發、半導體綠色環保型清洗劑、第三代半導體前端製程光阻去除、載板/mSAP 剝膜促進劑、先進封裝用暫時性膠著膠、高耐熱 UV 解膠膠帶
114 年度	CPO 氧化層蝕刻液、HBM 製程蝕刻液、MOSFET 製程蝕刻液、半導體殘留物去除、黏接層清洗劑

(四)長、短期業務發展計畫：

1.短期發展計畫

①半導體產業

A.持續爭取與客戶合作機會，增加用於先進封裝等製程產品數量。

B.拓展市場渠道及提升覆蓋率為目標，以本公司去光阻及清洗劑產品進行客戶認證，並導入其生產供應鏈，提高客戶覆蓋率，再拓展客戶不同製程應用提高滲透率，提升產品銷售量。

C.通過認證客戶之通路，利用本公司各項完善設施與資源，如業務、應用工程、研發與後勤服務團隊等，代理銷售客戶需求之產品，可提高營收，增加收益。

D.掌握中國去美化、自主化之商機。整合台灣的半導體原料及零件推展實績，應用於中國市場。

E.進入去中化市場，整合台灣的半導體原料及零件推展實績，應用於東南亞市場。

F.延攬多元專業人才加入新事業發展。

②特化產業

A.被動元件

深耕台灣大廠，跟進擴展東南亞國家。另外積極拓展中國市場滿足中低階需求。

B.載板及 PCB

除了持續深耕台灣與中國市場外，為因應未來持續成長的需求，日本高階市場已通過測試，韓國中大型客戶已在測試驗證中，迎合當地載板廠因應即將到來的環保及先進製程需求。

2.中、長期業務發展計畫：

①半導體產業

A.經營重點客戶，將資源集中於具競爭力、高前瞻性之市場領域，包含中國市場發展，積極開發新產品及新代理，以提升營業效益。

B.策略性發展產品，長期投入、評估及引進先進半導體及封裝關鍵新材料、第三代半導體、綠能領域關鍵料，尋找合適策略聯盟及合作對象。

②特化產業

A.被動元件產業

a.於東南亞設立分支機構就近服務客戶。可即時掌握客戶需求，靈活調整服務內容及產品供給結構，以滿足客戶需求，期許透過在地化佈局，擴展新藍海事業。

b.人才培育多方面發展，力求業務及研發產品動能無縫接軌。

B.載板及 PCB 產業

布局馬來西亞、菲律賓的 IC 載板客戶；開發泰國、越南的 FPC、HDI 先進製程需求客戶。

二、市場及產銷概況：

(一)市場分析：

1.主要商品之銷售地區(註)

單位：新台幣仟元；%

年度 地區	113 年度		114 年度	
	銷售額	%	銷售額	%
台灣	857,543	56.42	738,711	48.95
中國	615,466	40.49	710,552	47.09
其他	46,941	3.09	59,816	3.96
合計	1,519,950	100.00	1,509,079	100.00

註：本統計係按客戶所在國家計算，非產品最終銷售地點。

2.市場占有率

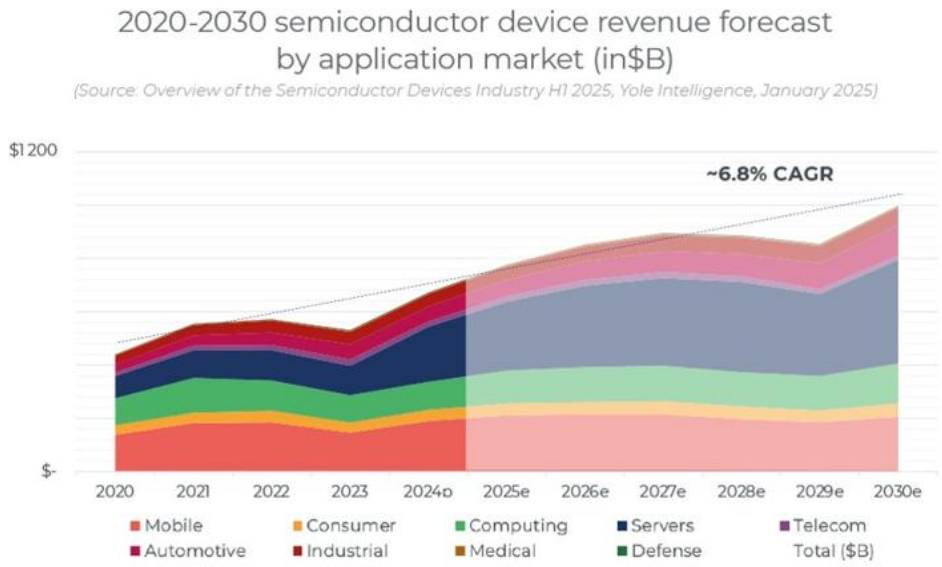
本公司最近三年度 65%以上之營收主要係來自半體製程用化學品及材料之銷售，而根據日商環球訊息有限公司市場調查報告書顯示，半導體化學品市場發展迅速，預計將以 11.9%的複合年成長率成長，從 2025 年的 132.7 億美元成長到 2026 年的 148.4 億美元。若以本公司 114 年度來自半導體之營業收入 10 億(約 0.32 億美元)推算，本公司於半導體製程用化學品及材料市場占有率約為 0.2%。

本公司已陸續於台灣及中國之半導體指標廠商成功導入客戶製程所需之產品，未來隨著客戶擴充產能，營收有望逐步成長，並將積極複製成功經驗開拓海外市場，故隨著本公司持續專注研發創新，提供客戶解決方案，相信未來隨著公司營運規模的逐步擴大，將有助於持續提升市場佔有率。

3.市場未來之供需狀況與成長性

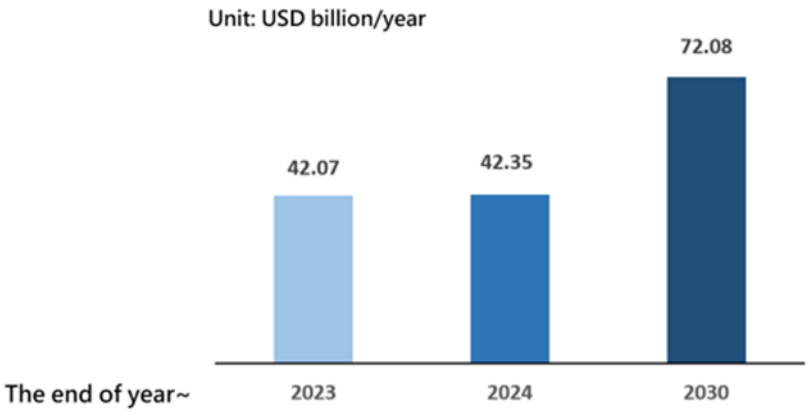
①半導體產業

根據 Yole Group 的資料預計未來幾年全球半導體市場將呈現 6.8%的年均複合成長率（CAGR），全球半導體市場的前景呈現持續正成長的榮景，預測在 2030 年全球半導體市場規模將達到 1 兆美金。



資料來源：Yole Group

A.AI 晶片持續微縮及擴產，依據 Global Information 資料顯示，2023 年高效能運算市場規模 420.7 億美元，2024 年將達 453.5 億美元，預計 2030 年將達 720.8 億美元，複合年成長率為 7.99%。台灣為先進半導體晶圓製造及封裝基地，成長可期。



資料來源：Global Information

B.HBM 需求擴大及產品精進，人工智慧（AI）需求爆發性成長，帶動高頻寬記憶體（HBM）市場強勁，彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence, BI) 的最新報告顯示，受人工智慧運算爆炸性成長和工作負載快速擴張的推動，該市場預計將以平均每年 42% 的速度成長，從 2023 年的 40 億美元成長到 2026 年約 350 億美元，十年末 2033 年的 1,300 億美元。另產品未來技術製程數量隨技術更新變多、製程用料增加，結構現 12 層將放量 16 層、開發 20 層，用料

呈倍數成長，如能提前突破製程技術、滿足客戶需求出貨，化學品用量將增加更多。

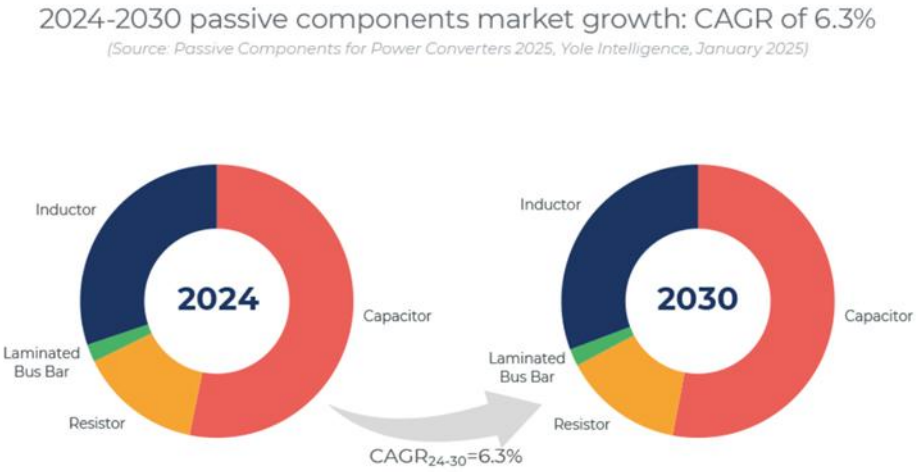
資料來源：彭博資訊

C.車用晶片持續成長，根據車輛研究測試中心資料顯示，2010 年一台汽車當中汽車電子約佔 30%成本，預估到 2030 年，將提升至 50%，若是將 AI 需求算進去，汽車電子佔比會更提升。原本一台汽車使用晶片約 200 顆到 300 顆，未來將攀升至 2000 顆以上；工研院產科國際所研究報告，預估 2040 年全球電動車銷售將上看 5000 萬輛，以此推算，屆時一年將會需要 1000 億顆以上晶片，相關製程化學品用量將跟隨之增加。另根據 SEMI 公布研究報告指出，在汽車產業對功率半導體、感測晶片、物聯網晶片、通訊晶片、AI 晶片等需求持續大增加，2028 年全球汽車電子市場規模將突破 4,000 億美元，年複合成長率可望達到 7.9%，汽車電子市場將成為各界競爭的焦點。

②特化產業

A.被動元件產業

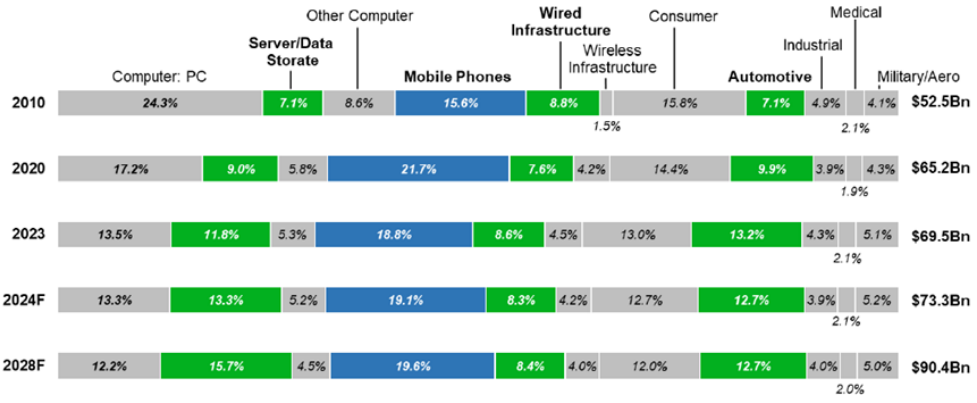
被動元件是電子產品的核心，廣泛應用於 PC、手機和平板。台灣產業價值鏈資訊平台指出，隨著 AI 伺服器、AI PC 和 AI 手機需求的增長，多層陶瓷電容器（MLCC）的需求相對上升，並推動高容、高壓 MLCC 的使用。除了 AI，車用電子市場也成為長期增長的動力，電動車每台所需的 MLCC 數量遠超傳統燃油車。根據 Yole Group 預測，被動元件市場將持續成長，預計在 2030 年達到總規模 272 億美元。被動元件包含電阻、電容與電感，及層壓匯流排(Laminated Bus Bar)。其中，電容市場不僅是目前規模最大的被動元件領域，也展現出強勁的成長動能，預估 2024 至 2030 年間將達到 6.3%的年均複合成長率。另一方面，電阻市場在 2024 年規模已超過 20 億美元，預期至 2030 年將接近 40 億美元，複合年增長率約為 6%。整體而言，被動元件市場正穩健成長。



資料來源：Yole Group

B.載板及 PCB 產業

根據 Prismark 的預估，多層 PCB 板市場的所有領域均有增長，其中以伺服器及資料存儲領域的成長最為強勁，預計總體伺服器和資料存儲應用的 PCB 市場規模將從 2024 年的 97.81 億美金提升至 2028 年的 142.21 億美金，2023-2028 年的 CAGR 複合增速為 11.6%，是平均 CAGR 增速的 5.4%的增速的 2 倍多。在各應用的產值持續成長，尤其以芝普主要布局之 FCBGA 受 AI、大數據發展需求持續勁揚，原載板先進製程的產品技術也可滿足 HDI、FPC 客戶下世代需求。



資料來源：Prismark

4.競爭利基

本公司具備高度競爭優勢，核心體現在自主技術開發能力、靈活高效的製造系統，以及在半導體與特化材料市場的實績與佈局，詳述如下：

①模組化生產製程與自主設計能力

A.兼具模組化、靈活性之生產製程配置，降低投入成本

本公司善於為半導體、PCB 及光電等相關產業研發特用化學產品，因此必須領先產業世代前進，不斷地推出新產品或將產品進行升級，以成為客戶長期

合作夥伴；因此必須將：1.各項製程需求所衍生之支援系統模組化(ex.加熱製冷、加壓負壓…等)；2.多項製程設備採整組移動式設計，配合各項一次側供應規格一致化，則可大幅提升其靈活性；兼具上述二項特質，則可在高支援性下同時達最經濟的成本投入及靈活的製程轉換，減少多項支援系統設備之需求與維護成本，同時能降低廠房空間需求量，皆能使製造成本更具產業競爭力。

B.擁有製程設備自主設計能力，具優異的品質控管

在半導體濕式製程中，使用之化學品佔製程關鍵角色，若使用的特化材料品質不佳，將大幅降低良率，導致大量晶圓報廢，甚至影響整個半導體廠產能。因此，半導體化學材料的品質控管非常重要；本公司的半導體先進製程化學品主要透過自主研發設計，再與設備廠商共同設計開發製程設備，可將產品純淨度推進至先進製程高純淨度 ppt 及 0.1um 等級的技術能力，更自行開發完整的 QC flow chart 化驗分析方法並透過優異的分析能力對不純物(金屬、微粒子…等)微量分析而達到 ppt 及 0.1um 等級之控管；於品管上，更依循 ISO9001 品質規範，結合 SPC 統計方法監控製程，掌握製程變異以提供客戶品質優異且穩定的產品，取得客戶信賴，成為長期夥伴。

②於半導體與特化市場建立技術與客戶優勢

A.半導體產業

a.現為先進封裝製程用料供應商之一，持續有新產品機會發生，並隨客戶成長營收增加。

b.掌握核心配方開發技術，持續開發新產品，過程歷練出對於去光阻及清洗劑特性的豐富瞭解，衍生產品核心技術，相關經驗與技術已於市場得到驗證及肯定，現已有優於同業產品導入，在客戶端取得進展。

c.具成本優勢，在化學品行業耕耘近 40 年，相關供應鏈豐富，可滿足客戶高、中、低階的要求。

d.取得多家半導體先進製程客戶認證，並維持良好穩定之客戶關係。

e.在地化供應，相較對手在服務速度及效率，具有更好利基。

f.台灣半導體產業為技術先行者，與客戶合作開發之產品，可複製至亞洲甚至全球客戶使用。

B.特化產業

憑藉在半導體市場技術開發的基礎，可快速地提供被動元件&載板客戶開發先進製程所需要的產品：

a.技術創新與專注差異化研發：專注於市場尚未解決的痛點，例如超小孔徑的均勻填孔、高導電率或高耐用性電鍍液，以提供獨特價值。

b.與客戶共同開發：與 PLP 製造廠商或終端客戶建立深度合作，了解其需求並共同開發產品，縮短導入時間並增加技術黏著度。

c.實驗室到市場的無縫連接：設立小規模試產線，快速測試新配方並將成熟技術迅速推向市場。

d.提供即時技術支持：針對電鍍液使用過程中的問題，提供高效的售後服務與技術支援，增強客戶信任度。

e.建立策略聯盟：與原材料供應商、設備製造商及終端客戶合作，共同開發新技術並分擔風險。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A. 有利因素

a.HPC 需求擴大呈供不應求狀況

HPC 只能以先進封裝製程完成，隨終端市場方興未艾先進封裝廠擴產計畫加速並放大增量，已導入產品用量持續增加，新導入產品用量跟著增長。

b.半導體先進製程持續演進，高階化學品需求可期

本公司所產製之高階化學品在先進濕式製程上有更好的效益表現，受惠於 AI 加速器的 AI 訓練需求增加、AI PC 的換機需求，以及隨著智慧型手機、伺服器、Wi-Fi7 升級更高效能需要更多先進製程之應用等終端市場需求，各家晶片製造廠的製程不斷推進，對於高階化學品需求亦持續增加，產品符合半導體先進製程之市場潮流趨勢。

c.位於台灣半導體產業聚落之優勢地理位置

根據 SEMI（國際半導體產業協會）的估計，2025 年全球半導體產業將有 18 座新晶圓廠啟動興建。這些新建的晶圓廠以 12 吋晶圓廠為主，共計 15 座，另有 3 座為 8 吋晶圓廠，大部分廠房將於 2026 年至 2027 年開始營運量產。本公司位於全球半導體晶片生產樞紐地帶核心，不僅可提供客戶迅速緊密的產品支援與售後服務，並可配合客戶產品開發計劃，掌握先進製程最新趨勢。此外，優質的地利提供了快速交貨之競爭優勢。

d.產品線豐富且具競爭力

本公司產品線布局完整，涵蓋半導體黃光、蝕刻、清洗、薄膜及擴散等關鍵製程，同時將產品延伸至綠能產業及先進封裝技術，透過客製化服務強化市場差異化優勢，多元化的產品組合有效分散營運風險，降低單一產品競爭波動對整體業務的衝擊。在現行客戶增加新銷售產品，擴大營業額，在先進封裝領域，台灣作為全球技術研發重鎮，本公司已深耕數年，密切配合客戶開發需求，終端產能可望爬升，將同步帶動對本公司產品採購量的實質成長。

B. 不利因素與因應對策

a.競爭廠商投入化學品開發

化學品對半導體製程是非常重要的原材料，部分高單價之電子特殊化學品，歐、美、日、中國及台灣多家廠商相繼投入產品的研發。

因應對策

鑑於晶片製程所需之電子化學品在地化之趨勢及全球半導體需求逐漸提

高，本公司正與先進半導體客戶緊密合作，持續規劃開發去光阻產品、先進清洗類產品、環保類等產品，可涵蓋半導體產業在電晶體生成循環製程所需之多項精密特殊化學品，本公司將持續精進提升技術及品質，同時符合客戶先進製程對原料更高性能要求，增加客戶對本公司產品的依賴度及後進競爭者踏入特殊化學品的難度。

b.關於產品代理、經銷之穩定性

本公司營收部份來自產品代理、經銷，故產品代理、經銷的穩定性，是營收能否穩定成長的因素之一。

因應對策

本公司與主要產品的上游供應商間，秉持著誠信及合法合規的前提，建立了長期友好的合作關係，並在產品技術及市場推廣方面，建立透明高效的溝通機制，以積極的策略提升代理權價值，維持良好的夥伴關係，共同面對市場的挑戰與機會。為確保供貨穩定性，除與供應商保持良好關係外，另持續研發新產品加深自有產品的產品深度，並與客戶緊密合作持續，以加強公司產品組合，提高核心競爭。此外，本公司同時運用微量元素分析實驗室及倉儲服務等競爭優勢，精選優良化學品與材料合作夥伴組成策略聯盟，以合作產銷方式豐富產品組合，以提供客戶更完整迅速的服務。

c.專業技術人才培養及招募不易

須投入長時間培育研發及業務人員之經驗及專業能力，與客戶研發設計產品時，會需要充足且高素質之業務及研發人員，而公司位於桃園市八德區，位居台灣精密化學品製造重要聚落，招募及留任專業技術人才遭受相當大的競爭。

因應對策

本公司除持續提升員工薪資及各項福利與獎金外，也投入員工健康職場，定期舉辦各類健康講座及各類型的健康促進活動，重視員工維持工作與生活平衡，另本公司技術為自行研究開發，未來加強教育訓練培育員工，同時擬透過申請股票上櫃公司打開知名度，吸引並留住更多優秀人才。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1.主要產品之重要用途

類別	用途
半導體製程用化學品及材料	應用於半導體晶片製造之薄膜、黃光、蝕刻清洗及先進封裝
特用化學品及材料	應用於高階載板製程 應用於被動元件製程 應用於玻璃中介層 TGV 製程

2.產品之產製過程

本公司擅長為半導體、PCB 及光電等相關產業研發特用化學產品，主要透過自主研發，並根據不同製程的要求進行模組化設計，使得產品可以根據客戶需求進行客製，在此用簡要的描述製造流程：

IQC 原料入料 ➡ 原料前處理入料➡ 調配/均質化/加工/純化 ➡

IPQC 製程中檢驗➡充填分裝➡FQC 成品檢驗➡成品入庫➡OQC 出貨檢驗

(三)主要原料之供應狀況：

本公司之主要原料為化學品及材料等。本公司之主要供應商皆屬長期配合之廠商，且雙方均維持良好穩定的合作關係，生產穩定及供應量充足。

(四)最近二年度任一年度中曾占進、銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進、銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1.最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元；%

項目	名稱	113 年度			114 年度		
		金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	A 公司	306,814	20.19	無	39,958	2.65	無
2	B 公司	105,299	6.93	無	170,275	11.28	無
其他		1,107,837	72.88	無	1,298,846	86.07	無
銷貨淨額		1,519,950	100.00		1,509,079	100.00	

增減變動說明：114 年度對 A 公司銷售減少，主係終端半導體客戶拉貨力道趨緩，以及 A 公司因其營運規畫，分散由另一家公司對本公司下單；對 B 客戶之銷售增加主係客戶需求增加。

2.最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元；%

項目	名稱	113 年度			114 年度		
		金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
1	甲公司	301,726	25.07	無	350,631	31.31	無
2	乙公司	142,768	11.86	無	131,154	11.71	無
3	丙公司	278,812	23.16	無	126,690	11.31	無
其他		480,340	39.91	無	511,234	45.67	無
銷貨淨額		1,203,646	100.00		1,119,709	100.00	

增減變動說明：本公司對上述進貨供應商之進貨金額變動，主要係隨客戶訂單需求變化而有消長。其中 114 年度對丙公司之採購比重減少，主係終端半導體客戶需求減少

所致；另外，對甲公司採購比例呈現逐年上升之趨勢，主要係外銷客戶需求增加所致。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

單位：人；%

年度		113 年底	114 年底	115 年截至 3 月 31 日止
員工人數(人)	直接人員	11	10	11
	間接人員	97	101	106
	合計	108	111	117
平均年歲		41	41	41
平均服務年資(年)		10	8	8
學歷分佈比率(%)	博士	1%	1%	1%
	碩士	20%	18%	20%
	大專	68%	71%	70%
	高中	7%	6%	5%
	高中以下	4%	4%	4%

四、環保支出資訊：

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額：無。

(二)未來因應對策及可能之支出：無。

五、勞資關係：

(一)本公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1.員工福利措施與實施情形

本公司依勞動相關法令辦理勞工保險、全民健康保險，使同仁有所保障。另本公司為充分照顧員工，由管理部及總經理室人資課分別統籌規劃員工之各項福利措施與運作，以提升員工福利。本公司之福利措施如下：

A.福利補助：結婚禮金、住院慰問、喪葬慰問等。

B.文康活動：年度旅遊、尾牙活動安排、部門聚餐、公益活動等。

C.其他補助：三節禮金、員工酬勞、績效獎金、團體保險、定期員工健康檢查、特約飯店住宿優惠等。

2.進修及訓練

A.內部訓練：新進員工教育訓練、部門內部教育訓練、環境安全訓練、其他內部專業講師課程、直接人員訓練、消防逃生訓練、工安訓練、業務基本訓練、製程訓練。

B.外部訓練：各部門主管及員工依工作需求，申請派員參加外部企業機構舉辦之課程與訓練。

3.退休制度與實施情形

本公司為安定員工退休之生活，藉以提高在職之服務精神，本公司遵守相關勞資法令，按月依員工薪資提撥6%之退休金至個人退休金帳戶中，除提供新制退休金外，本公司亦依勞工退休金提撥及管理辦法規定，已依法與勞工結清舊制年資完畢。

4.勞資間之協議情形

本公司重視同仁之意見，定期召開勞資會議，如必要時則加開臨時會議，邀請全公司同仁參與並鼓勵同仁提供建言，以瞭解同仁對管理及福利制度之意見，作為改善之參考，故截至目前勞資雙方關係和諧，並無爭訟事件及勞資間關係尚須協調之情形。

5.各項員工權益維護措施情形

本公司訂有員工工作規則、員工手冊，明示員工福利項目，定期檢討福利內容，並確實執行福利內容，維護員工權益。

(二)近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失等：無。

六、資通安全管理：

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1.資通安全風險管理架構：

本公司以資通安全為企業永續營運之基石，由總經理擔任資安組織最高權責主管。整體資安政策目前由資訊單位統籌與執行，負責識別、評估、處理及監控各項資通安全風險；未來亦將依據相關法令規範與營運發展需求，逐步評估與規劃資安專責人力之配置。資訊單位將持續推動全體員工之資安意識宣導，確保防護機制之有效性與合規性。

2.資通安全政策

為促使本公司各項資通安全管理制度之執行與監督，維護重要資訊系統之機密性、完整性與可用性，制定資通安全政策。本政策旨在防範人為疏失、蓄意破壞或自然災害所導致之資產不當使用、洩漏、竄改、毀損或遺失，確保公司營運不中斷。具體政策方針如下：

- **法規遵循：**各項資通安全作業皆須嚴格遵守政府相關法規（如：資通安全管理法、個人資料保護法、營業秘密法及智慧財產權相關法規等）。
- **教育訓練：**定期辦理資通安全教育訓練，宣導資安政策、法令遵循及實施規範，深化全員資安文化。
- **存取與資源管理：**建立主機、網路及系統存取之權限控管機制，統籌分配並妥善運用資訊資源。
- **環境與實體安全：**強化資訊機房之實體與環境安全防護措施，並定期執行維護

與保養作業。

- **營運持續計畫**：制定資料備份與系統還原機制，並定期辦理災難復原演練，確保公司業務持續運作。
- **全員參與責任**：本公司所有人員均負有維持資通安全之責任，且應恪守公司資安管理規範。
- **專案與機敏資料保護**：於內、外部專案管理過程中，嚴格控管資訊之機密性與完整性，降低機敏資訊（含個人資料）外洩及違規風險。
- **持續改善機制**：確保資安管理制度之適足性與有效性，以因應內外部環境變遷，維持穩健之營運與服務量能。

3.具體管理及投入資通安全管理之資源

本公司定期檢視整體資通安全藍圖，與時俱進並持續優化防護能量，具體方案與資源投入如下：

- **制度規範**：內部已訂定多項資安規範，並積極推動導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，依計畫執行風險評估與各階段查核。每年定期檢視制度是否符合營運環境與最新技術標準，並適時修訂調整。
- **系統防護與基礎建設**：為防禦內外部資安威脅，建置防火牆、防毒軟體等各式資安防護系統；重要伺服器與系統皆採虛擬化架構部署，並建置雲端異地備援機制。同時，設計作業程序稽核機制，落實人員存取控管。
- **主動檢測與演練防護**：每年定期辦理弱點掃描、滲透測試，以及針對全體員工的社交工程演練，主動發掘潛在風險並即時修補，提升基礎設施防禦力。
- **人員訓練與資源挹注**：定期實施新進人員及在職同仁之資安實務課程與機會宣導。公司深信「人員」為資安防線之核心，未來將持續投入資源提升全體同仁之網路安全風險意識，共同守護公司資訊資產。

(二)列明最近二年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
授信合約	合作金庫銀行	102/01/31~119/01/31	資本性支出貸款	土地及建物抵押
授信合約	合作金庫銀行	115/03/17~120/03/17	中期週轉貸款	土地及建物抵押
授信合約	合作金庫銀行	115/03/17~116/03/17	營運週轉貸款	無
授信合約	台北富邦銀行	113/05/22~128/05/22	資本性支出貸款	土地抵押
授信合約	台北富邦銀行	115/03/13~116/03/13	營運週轉貸款	無
授信合約	兆豐國際商業銀行	114/10/29~115/10/28	營運週轉貸款	無
授信合約	中國信託商業銀行	114/07/31~115/07/31	營運週轉貸款	無
授信合約	第一商業銀行	114/04/30~115/04/30	營運週轉貸款	無
授信合約	國泰世華商業銀行	114/03/11~115/03/11	營運週轉貸款	無
工程合約	帆宣系統科技(股)公司	113/01/15~115 年工程完工日	建廠增建工程	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，未來因應計畫等：

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年	114 年	差異	
			金額	%
流動資產	570,867	640,232	69,365	12.2%
不動產、廠房及設備	397,752	466,479	68,727	17.3%
無形資產	1,300	2,119	819	63.0%
其他資產	21,222	51,530	30,308	142.8%
資產總額	991,141	1,160,360	169,219	17.1%
流動負債	367,544	436,685	69,141	18.8%
非流動負債	106,956	178,880	71,924	67.2%
負債總額	474,500	615,565	141,065	29.7%
股本	206,987	222,370	15,383	7.4%
資本公積	18,724	20,159	1,435	7.7%
保留盈餘	286,939	299,193	12,254	4.3%
其他權益	3,991	3,073	(918)	(23.0%)
非控制權益	—	—	—	—
權益總額	516,641	544,795	28,154	5.4%

資料來源：各年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

1.重要變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣壹仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：

(1) 其他資產增加：主係預付設備款增加所致。
(2) 非流動負債增加：主係長期借款增加所致。

2.重大變動項目之未來因應計畫：上述變動對本公司財務、業務並無重大影響。

二、財務績效：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，未來因應計畫等：

(一)最近二年度財務績效分析比較表

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年	114 年	增(減)金額	變動比率(%)
營業收入	1,519,950	1,509,079	(10,871)	(0.7%)
營業成本	1,181,635	1,158,147	(23,488)	(2.0%)
營業毛利	338,315	350,932	12,617	3.7%
營業費用	266,211	277,073	10,862	4.1%
營業淨利	72,104	73,859	1,755	2.4%
營業外收入及支出	6,807	(3,270)	(10,077)	(148.0%)
稅前淨利	78,911	70,589	(8,322)	(10.5%)
所得稅費用	14,981	13,443	(1,538)	(10.3%)
本年度淨利	63,930	57,146	(6,784)	(10.6%)
本年度其他綜合損益(稅後淨額)	2,554	(918)	(3,472)	(135.9%)
本年度綜合損益總額	66,484	56,228	(10,256)	(15.4%)
資料來源：各年度經會計師查核簽證之合併財務報告。 1.重要變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣壹仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下： (1) 營業外收入及支出減少：主係衍生性金融商品評價損失增加所致。 2.未來因應計畫：不適用。				

(二)預計銷售數量與其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計畫：

本公司主要係依據當年度銷售情況、市場需求及產業發展，訂定隔年度之銷售業績，預估本公司未來營業規模仍可持續成長，對財務業務狀況帶來正面助益。

三、現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析：

(一)最近年度現金流量變動分析：

單位：新台幣仟元

年　度 項　目	113 年度	114 年度	增(減)金額	增(減)比例
營業活動之淨現金流入(出)	70,587	62,208	(8,379)	(11.87%)
投資活動之淨現金流入(出)	(68,905)	(108,360)	(39,455)	57.26%
籌資活動之淨現金流入(出)	(30,414)	110,914	141,328	(464.68%)

現金流量變動情形分析：
(1)營業活動淨現金流入減少：主係 114 年度應收帳款增加所致。
(2)投資活動淨現金流出增加：主係購置固定資產及廠房擴建工程所致。
(3)籌資活動淨現金流出減少：主係 114 年度舉借長期貸款支付擴建工程款所致。

(二)流動性不足之改善計劃：本公司並無流動性不足之情事。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金流入(2)	預計全年來自投資活動淨現金流出(3)	預計全年來自籌資活動淨現金流出(4)	預計現金剩餘(不足)數額(1)+(2)+(3)+(4)	預計現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
269,958	442,378	(100,198)	(152,324)	459,814	—	—

1.未來一年現金流量變動情形：

(1) 營業活動：預計持續獲利使營業活動產生淨現金流入。
(2) 投資活動：主係購置及汰換設備產生之淨現金流出。
(3) 融資活動：主係支付現金股利所致。

2.預計現金不足額之補救措施及流量性分析：本公司最近年度尚無現金流量不足之虞。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司最近年度重大資本支出主要為擴展業務需求之建廠工程及購置設備，由於本公司營運狀況良好，來自於營業活動之現金流入穩定，建廠及購置設備之資金來源係以自有營運資金及長期銀行借款支應，故對公司財務業務並無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

(一)轉投資政策：

本公司專注於本業，投資決策及作業程序遵循經本公司訂定之內部控制「投資循環」、「取得或處分資產處理程序」，以執行相關投資事宜。另訂定「子公司監控作業辦法」等規範，以便督促各子公司針對重大財務、業務事項訂定相關作業程序，並監督其依法執行或辦理。此外，本公司亦對轉投資事業隨時掌握其營運狀況，以利投資後之追蹤管理。

1.轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

單位：新台幣仟元

轉投資公司	主要營業項目	114 年度認列之投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
E-CHEM HOLDING CO., LTD.	一般投資業	6,470	投資大陸地區子公司獲利	-
PROCHEM HOLDING CO., LTD.	一般投資業	3,696	投資大陸地區子公司獲利	-
PALLATECH CO., LTD.	國際貿易業	1,562	執行金融商品獲利	-
芝普融祥(上海)貿易有限公司	化學品原物料批發	1,658	大陸市場銷量成長，營收及獲利穩定	-
昆山芝普融祥貿易有限公司	化學品原物料批發	2,090	大陸市場銷量成長，營收及獲利穩定	-

2.未來一年投資計劃：無。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113 年度		114 年度	
	金額	占營收淨額比率	金額	占營收淨額比率
利息收入	2,279	0.15	1,855	0.12
利息費用	4,787	0.31	4,210	0.28

資料來源：113 年度及 114 年度會計師查核簽證之合併財務報告

本公司 113~114 年度利息收入占各期營業收入淨額比率分別為 0.15%及 0.12%，主要係銀行存款利息收入；113~114 年度利息費用占各期營業收入淨額比率分別為 0.31%及 0.28%，主要係本公司為營運需求及資本支出向金融機構借款所產生之融資利息，市場利率雖有所波動，惟利息收入與利息費用占營收淨額比率微小，故不致對本公司營收及獲利造成重大不利之影響。本公司未來將定期評估銀行借款利率，與銀行間保持密切聯繫以取得較優惠之利率，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

2.匯率變動

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113 年度		114 年度	
	金額	占營收淨額比率	金額	占營收淨額比率
兌換利益(損失)	3,241	0.21%	1,451	0.10%

資料來源：114 年度及 114 年度會計師查核簽證之合併財務報告

本公司對國外進貨廠商之採購係以美元、人民幣或日幣計價，而國外銷貨係採美元或人民幣計價，113~114 年度兌換利益(損失)占營收淨額比率分別為 0.21%及 0.10%，產生兌換利益(損失)主要係因美金及人民幣匯率波動所致，兌換利益(損失)佔營收淨額比率微小，主要係本公司在外幣資金管理上採穩健保守原則，以自然避險為主，將外幣計價產品收入之外幣應收帳款用來支應以外幣計價採購產生之外幣應付款項。此外，本公司亦持續對於主要交易幣別之貨款進行適度之避險，依營運狀況，搭配遠期外匯合約以規避匯率變動之風險，且本公司隨時蒐集國際匯率變動資訊，並與銀行保持密切聯繫，充分掌握國際匯率走勢及資訊，因此匯率變動對本公司損益影響程度仍屬有限。

3.通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

受全球原物料上漲影響，整體經濟環境呈現通貨膨脹之趨勢，本公司與供應商及客戶保持密切且良好互動關係，並密切關注原物料市場價格之波動，持續致力於各項成本之降低，適度調整產品價格及原物料庫存以為因應，截至目前本公司未有因通貨膨脹而對損益有重大影響之情事。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司專注於本業經營，並以財務穩健保守為原則，未從事高風險、高槓桿投資之交易。有關資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策，將依本公司訂定之「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」相關辦法規定，並考量財務業務需要辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1.未來研發計畫如下：

(1)半導體製程 SVHC 限制物質取代品開發及量產
(2)半導體蝕刻液開發及量產
(3)產品回收再利用製程研究
(4)製程中環保節能與污染預防
(5)半導體前端製程光阻去除進入量式

2.預計投入之研發費用

研究發展是維持競爭力的主要動力，近年來為因應客戶製程發展，研發費用

之支出呈逐年成長的趨勢。未來依據產業之製程方向與規劃之產品開發進度，視營運狀況調整投入之研發支出，並且持續提升研發能力及增添精密研發設備，期能逐步強化相關研發技術及能量，予以確保本公司產品競爭力。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司營運一向遵循國內外相關法規，並持續關注國內外政策的發展趨勢及法律變動，蒐集相關資訊供經營層決策參考，並適時諮詢律師、會計師等專業機構的意見，以便充分掌握並應對市場環境的變化，並在必要時調整營運策略。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司深耕半導體及特用化學領域，經營團隊持續密切關注國內外最新技術發展與產業趨勢。為因應科技快速變遷與市場需求之轉變，本公司積極與客戶及供應鏈保持緊密溝通，精確掌握產業供需動態。透過研發技術之優化與營運策略之彈性調整，本公司確保持續掌握市場先機，維持核心競爭優勢。

伴隨數位化科技進步，企業面臨之全球網路威脅亦日益嚴峻。本公司為有效防範駭客攻擊、惡意軟體及資料外洩等新型態風險，已建構涵蓋網路、資訊系統及端點設備之多層次防禦機制。

在具體因應作為上，本公司積極推動資訊架構優化（如系統虛擬化與雲端異地備援機制），並依循國際標準逐步導入 ISO 27001 資訊安全管理系統。同時，透過定期執行弱點掃描、滲透測試及社交工程演練等主動式檢測，輔以常態性之資安教育訓練，全面深化全體員工之資安意識與應變能力，以期將資通安全風險降至最低。本公司最近二年度及截至公開發行說明書刊印日止，並未因科技改變（含資通安全風險）或產業變化，而對本公司之財務或業務產生重大不利之影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持正直誠信、專注投入、團隊合作與開放包容的核心價值，強化公司治理並嚴格遵守各項法令規定，致力於實現企業的長遠發展與社會責任。最近年度及截至公開發行說明書刊印日止，本公司尚無因企業形象改變而對公司產生重大影響之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司及其子公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行企業併購計畫。未來若有併購計畫時，將依據相關法令之規定辦理之，以確實保障公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司新建擴廠計畫預計於 115 年第三季竣工，對於本公司增加倉儲空間及產能效率、強化接單能力將有所助益，未來將逐步擴大營業規模，將有利於達成公司營運目標並增加營收及獲利。本公司擴廠計畫已依相關之規定及法規執行，以期達成預計效益並同時將可能風險因素降低。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司 113 年度及 114 年度進貨前十大供應商金額占當年度進貨金額分別為 82.86%及 80.21%，進貨三大供應商金額占當年度進貨金額分別為 60.09%及 54.34%，故尚無進貨集中之風險，且本公司與各供應商均維持良好且穩定之合作關係，並將持續積極規劃尋求更多優良供應商，以確保主要原物料供應無虞，同時備置適量庫存，以避免供貨短缺或中斷之風險。

2.銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司主要銷售產品為半導體製程用化學品及材料、特用化學品及材料，113 年度及 114 年度銷售前十大客戶金額占當年度營業收入淨額分別為 57.59%及 53.22%，另並未有銷貨單一客戶占本公司營業額超過 30%之情事，故本公司並未有銷貨集中之風險。另本公司仍積極開發新客戶，並與原有客戶維持良好之合作夥伴關係，提高整體價值，故可將此類風險發生的可能性降至最低。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至本年報刊印日止，本公司尚無因董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權移轉或更換而對本公司之營運造成重大影響及風險。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至本年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

1.公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

本公司於民國 113 年 5 月至 114 年 2 月間銷貨予聯勝光電股份有限公司(以下簡稱聯勝)，聯勝應於 114 年 2 月至 4 月間給付之貨款共計新臺幣 2,056 千元，惟陸續逾期未為清償。本公司於 114 年 4 月 2 日寄發存證信函催告未果，遂於 114 年 5 月 9 日向臺灣臺中地方法院聲請支付命令，嗣因聯勝於法定期間內提出異議而轉為訴訟程序（以下簡稱本案）。為保全債權，本公司於 114 年 6 月 13 日向同院聲請假扣押，並經法院裁定准許。本案業經法院於 115 年 3 月 13 日為本公司勝訴判決，本公司將持續關注與辦理後續執行事宜。經評估，本案對股東權益或證券價格尚無重大影響。

2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從

屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料 ：關係企業合併營業報告書：請參閱公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

芝普企業股份有限公司

董事長：林士堯